

JEITA情報端末フォーラム2026

Beyond Devices - AIで拓く、情報端末産業の新領域と価値創造-

異次元の成長期に入った半導体産業を展望する

July 17, 2026

Akira Minamikawa

Senior Consulting Advisor

Akira.Minamikawa@omdia.com

JEITA

Brought to you by Informa Tech

OMDIA

自己紹介（南川明）

米インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティングディレクター



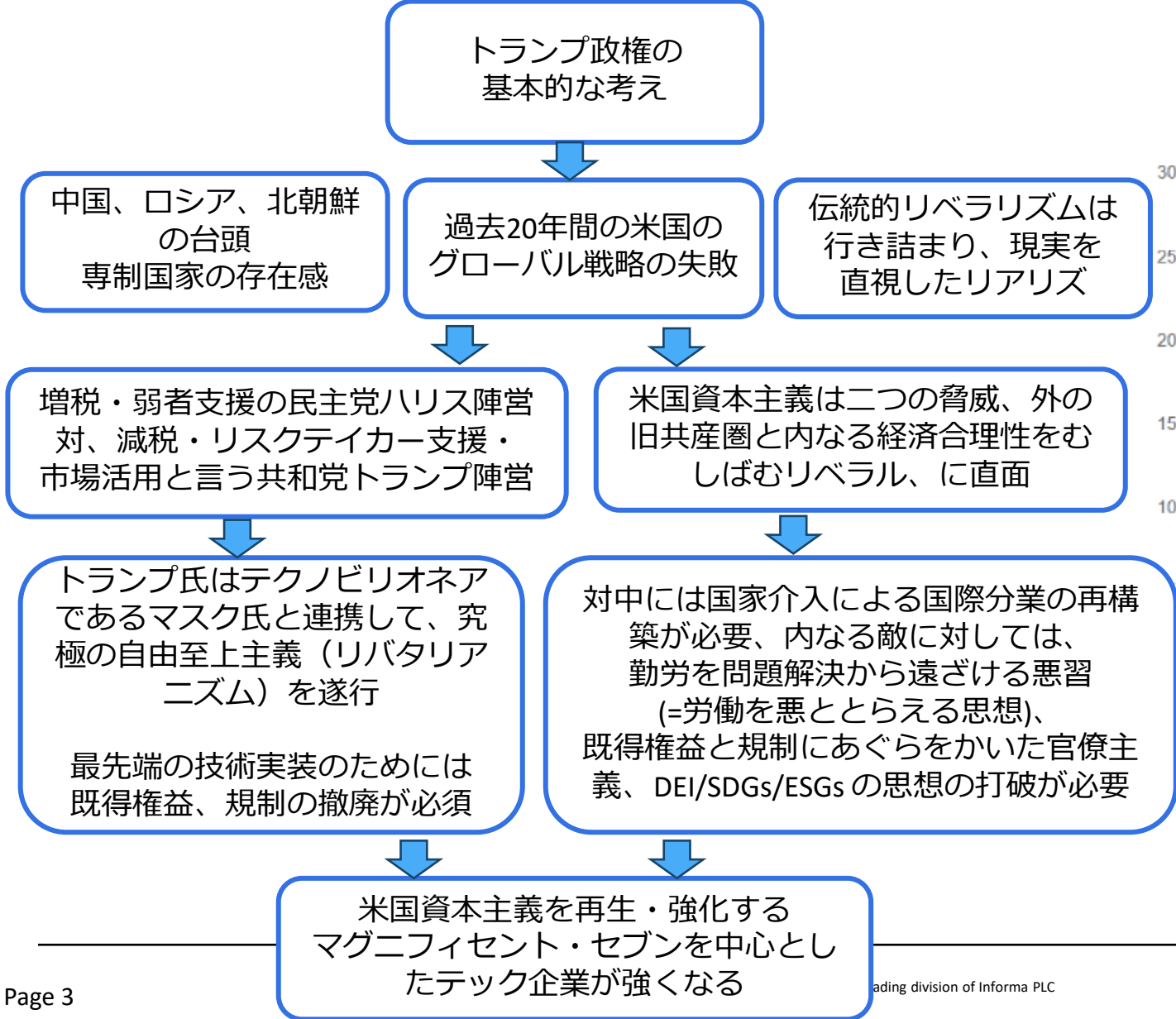
1982年 3月 武蔵工業大学電気工学科卒
1982年 4月 米モトローラ株式会半導体事業部
1990年 5月 米ガートナージャパン株式会社 半導体アナリスト
1996年 1月 米IDC Japan株式会社 半導体調査ディレクター
2000年 6月 WestLB証券会社 調査部 ディレクター&シニアアナリスト
2003年 4月 クレディーリヨネ証券会社 調査部 テクノロジーヘッド&シニア・アナリスト
2004年 7月 株式会社データガレージ 取締役社長
2010年 11月 米IHSグローバル株式会社 コンサルティングディレクター
2019年 8月 英インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティングディレクター
2025年 4月 Semi Business Consulting設立
(現在に至る)

JEITAでは20年間に渡り、世界の電子機器と半導体中長期展望委員会の中心アナリストとして従事する。

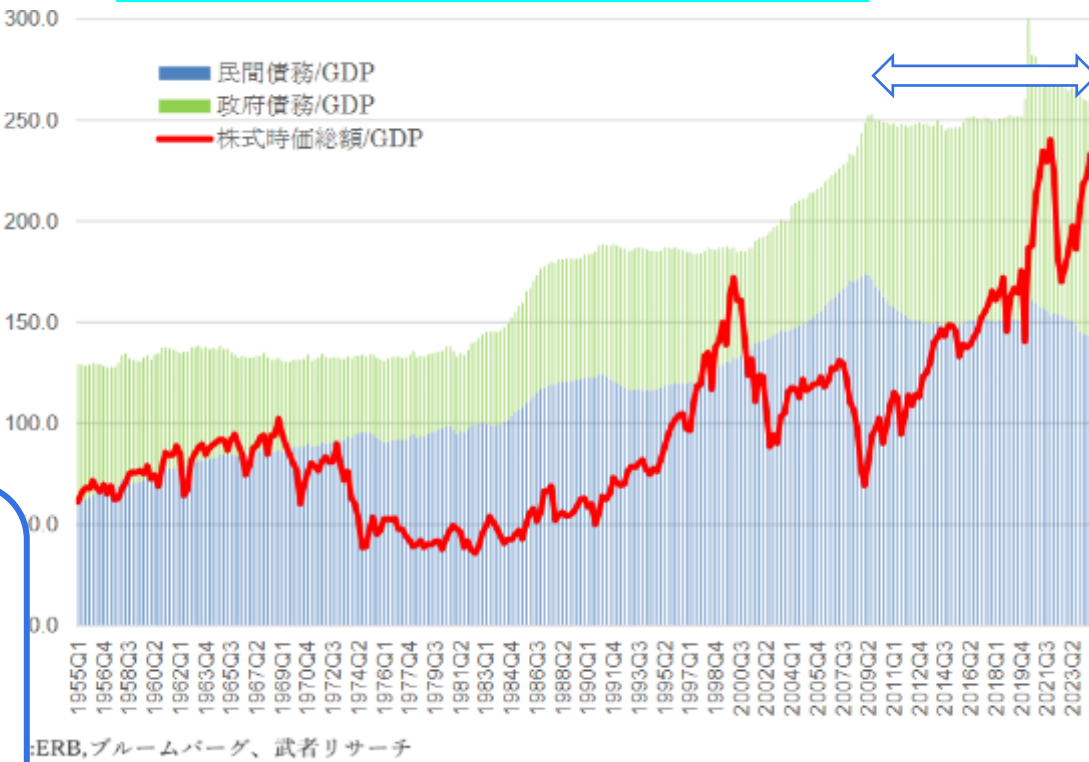
定期的に台湾主催の半導体シンポジウムで講演を行うなどアジアでの調査・コンサルティングを強化してきた。

特許庁の自動車用特許の技術審査委員、半導体関連特許審査委員、NEDOポスト5G技術審査委員、ROHM社外取締役、東京科学大オープンイノベーションアドバイザー、三菱商事アドバイザー、オランダ大使館アドバイザー、RISE-Aアドバイザー、三菱UFJ銀行アドバイザー、七十七銀行アドバイザー、Valvion Consultingアドバイザーなど。

世界の資本主義体制の危機とトランプ政権の考え方



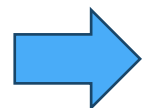
米国信用残高/GDP 比推移(対 GDP%)



ERB, ブルームバーグ, 武者リサーチ

トランプ政権の2026年戦略 半導体業界への影響は？

基本戦略は同じであるが



米国は2025NSS(国家安全保障戦略)を発表、これまでの米国の世界戦略を完全に否定

「米国の能力を過大評価し、グローバリズムと自由貿易に傾注した結果米国の力、富、良識の礎となった国家の特質が損なわれた」と総括した



世界人口の17%に過ぎない中国は世界製造業生産の4割弱(米国の2倍強)を集積し、鉄鋼5割、造船7割、スマホ、ドローン8割、PC、TV9割、ソーラパネル、EV、バッテリー、風力発電設備などで世界シェア6~8割と圧倒の高世界シェアを獲得している



中国の財政赤字は急拡大し対GDP比7%(2025年OECD推計)と主要国中最悪になっている



大幅な貿易黒字で稼いだ外貨の投資先として、一度は萎みかけた一帯一路などの海外投資を再拡大させグローバルプレゼンスを高めている



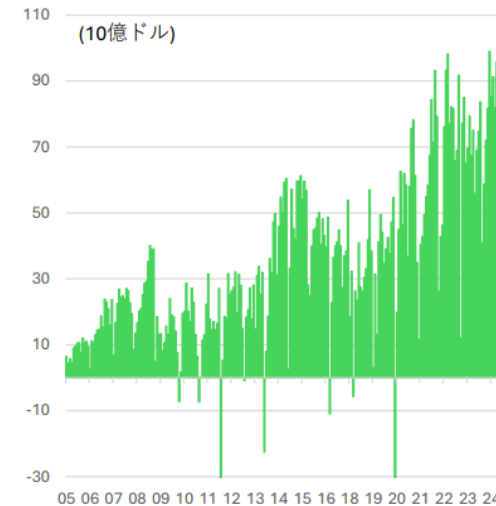
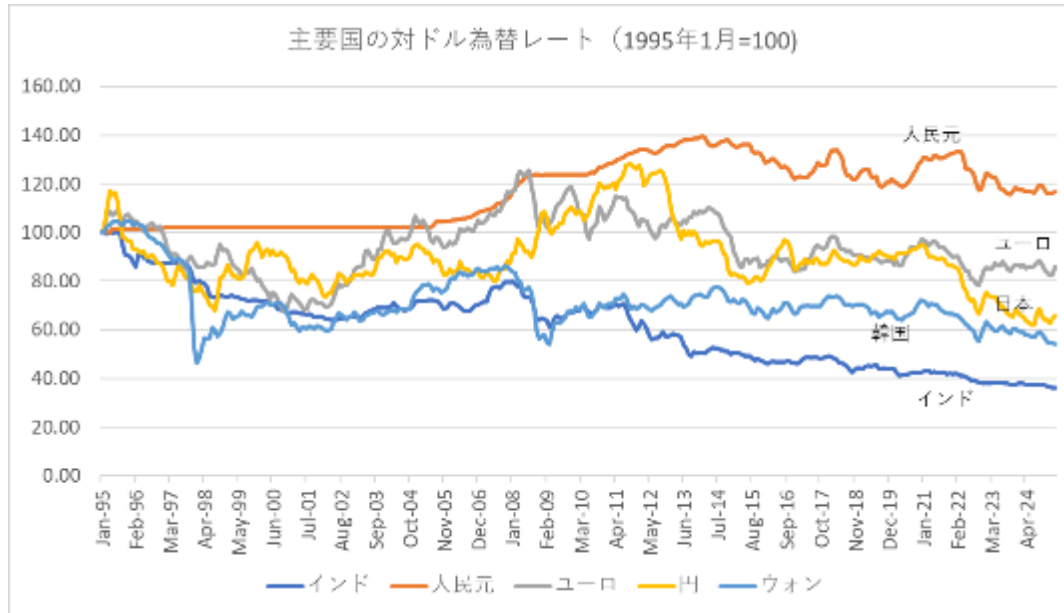
これまでの製造業ではない生成AIプラットフォームを活用したビジネスモデルをいち早く確立することと中国の過剰製造能力が行き詰まる戦略

中国は元高により製造業の競争力は落ち、日本とインドは回復期待できる

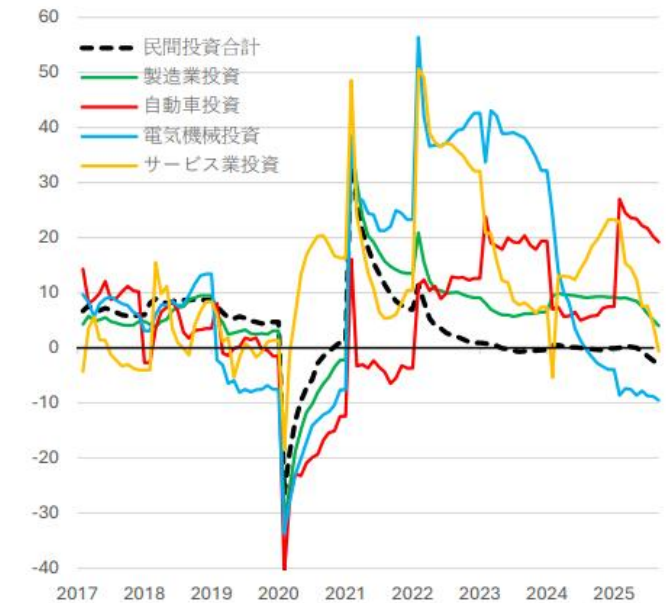
- 対中貿易制裁は効果が出ていないので、戦略を変える必要がある
- 日本円はバブル崩壊後実質実効レートが50%下落している、つまり円ドルレートが50%円安になっている。これと真逆なのが中国である。
- 中国は今後じわじわと輸出比率の高い企業は体力を落としてゆくことになる。
- 中国は投資も落ちてきているので、ここで米国がAI投資競争で勝ちに行く

中国民間設備投資推移

中国貿易黒字急拡大



出所:中国外貨管理局、武者リサーチ

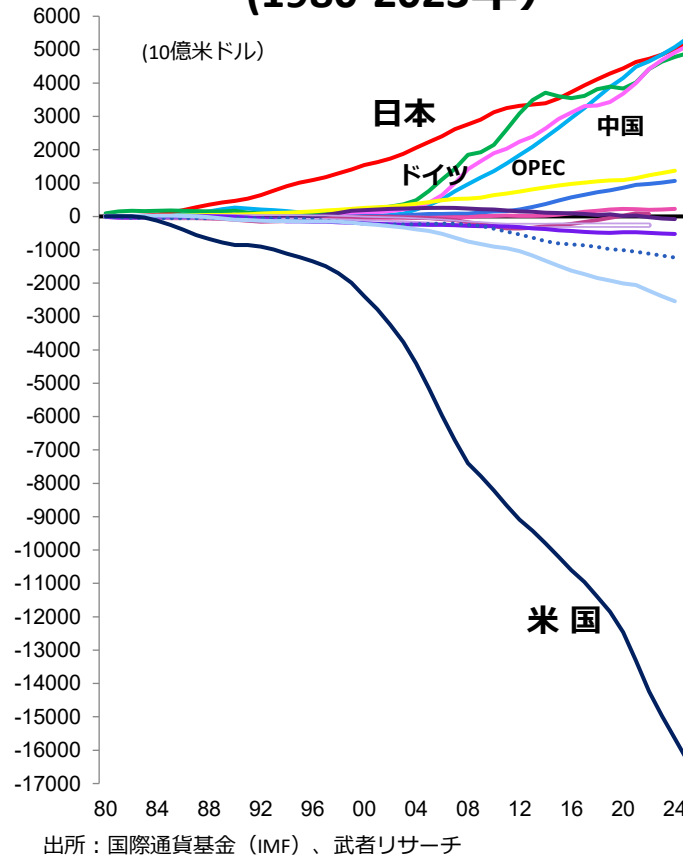


出所:ブルームバーグ、武者リサーチ

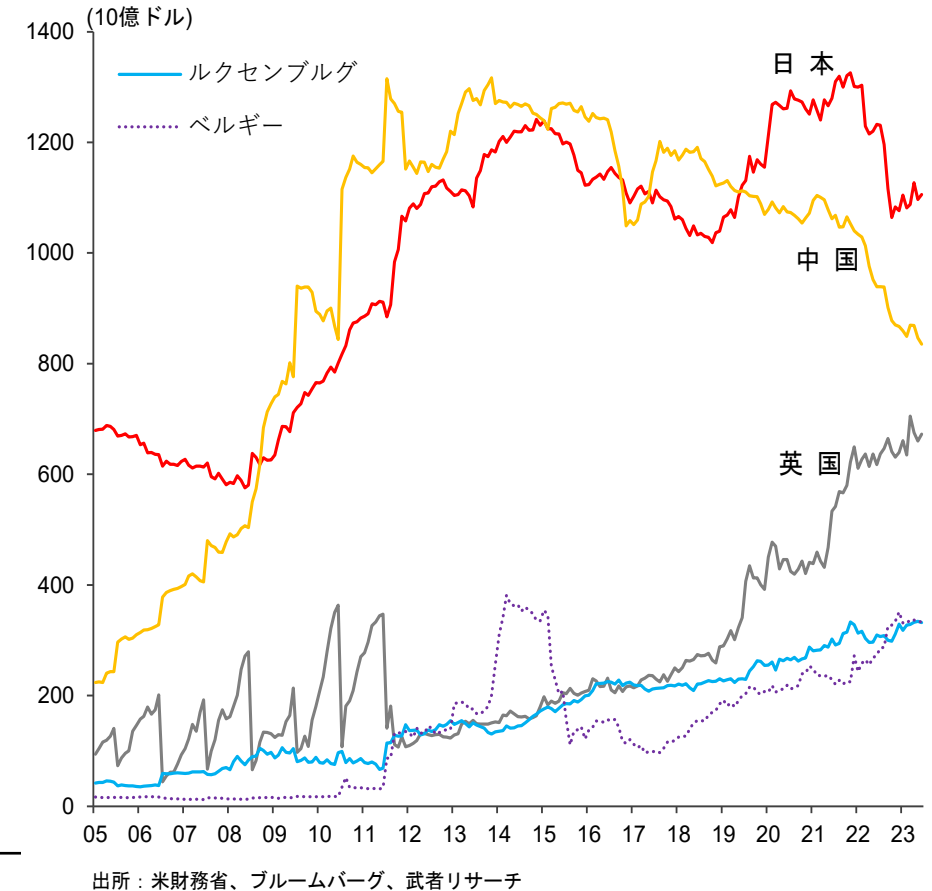
米国の国債をささえている日本、ステーブルコインで米国債の需要拡大

- 米国の経常収支累積は急拡大しており、金利返済だけでも大きな負担。
- 日本は米国の国債保有額トップで買い支えている。
- 日本は米国を支えている側面があり、米国は日本への圧力を掛け続ける事はしないと思われる。
- ステーブルコイン発行には米国債を保有することが必要となり、最大の保有国日本への恩恵は大

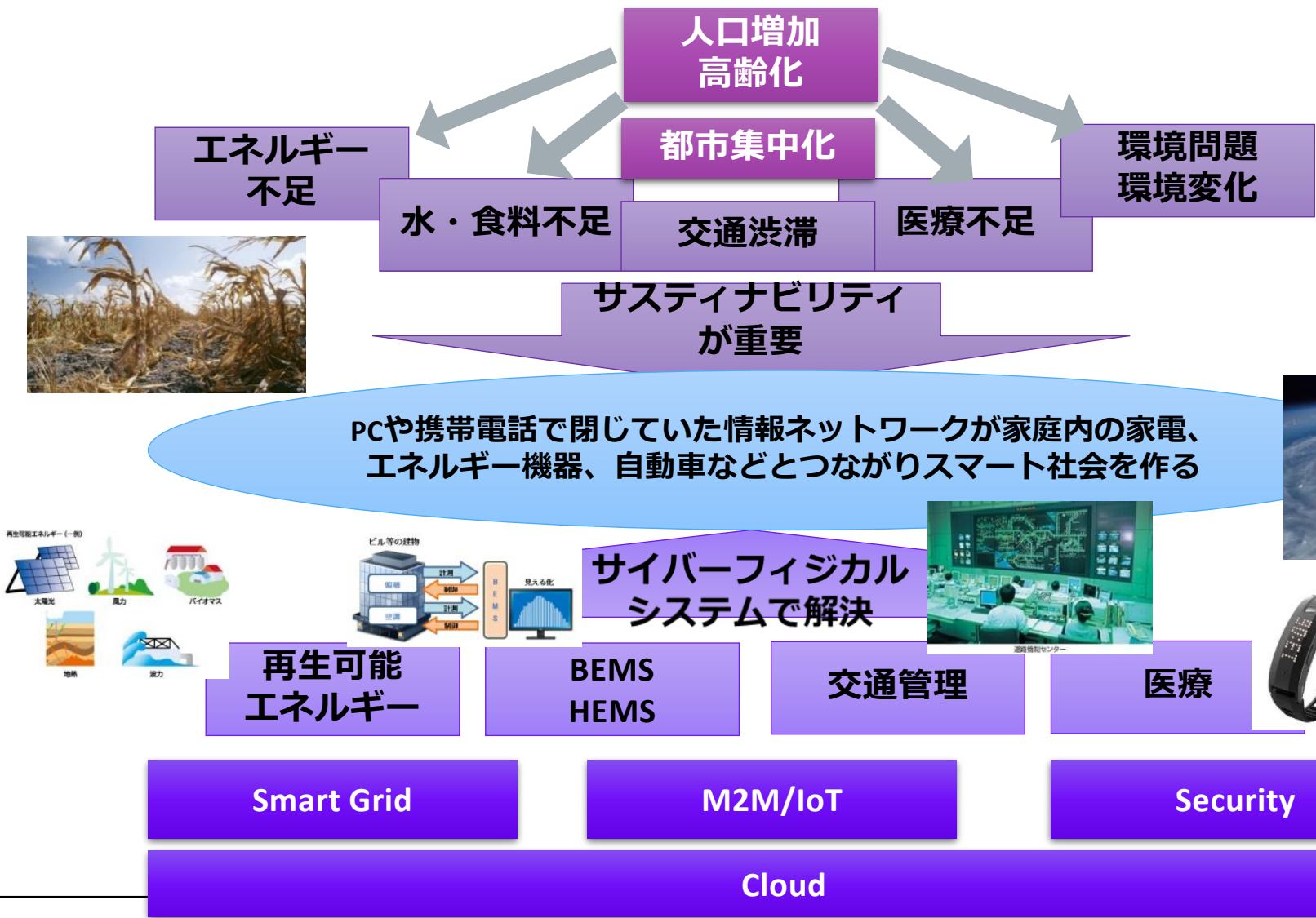
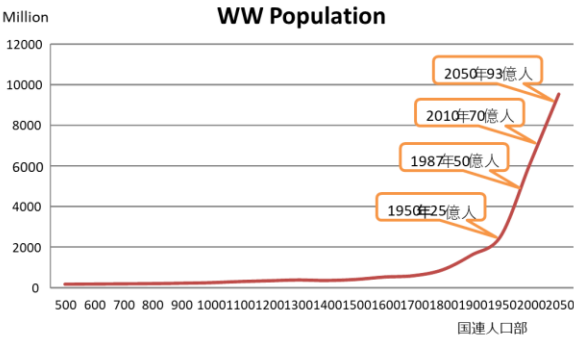
主要国の経常収支累積 (1980-2023年)



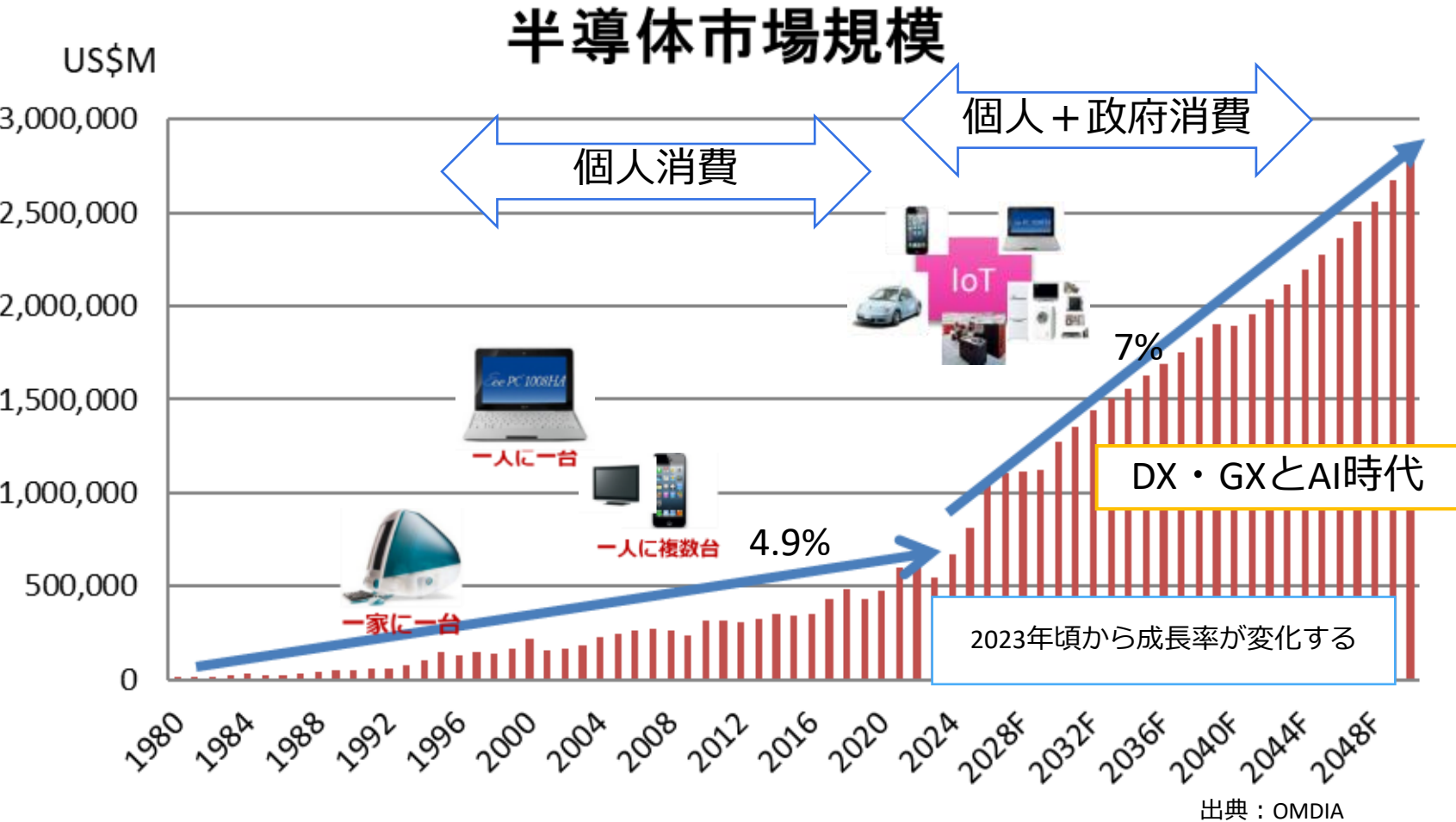
米国国債保有額トップ5



世界の3大メガトレンドが環境破壊を起こしている IoT活用したスマート社会がこれらの問題を解決する



個人消費から個人 + 政府消費が始まり新たな成長期に入った



2030年までに
DX投資：200兆円
GX投資：1,500兆円
AI投資：400兆円

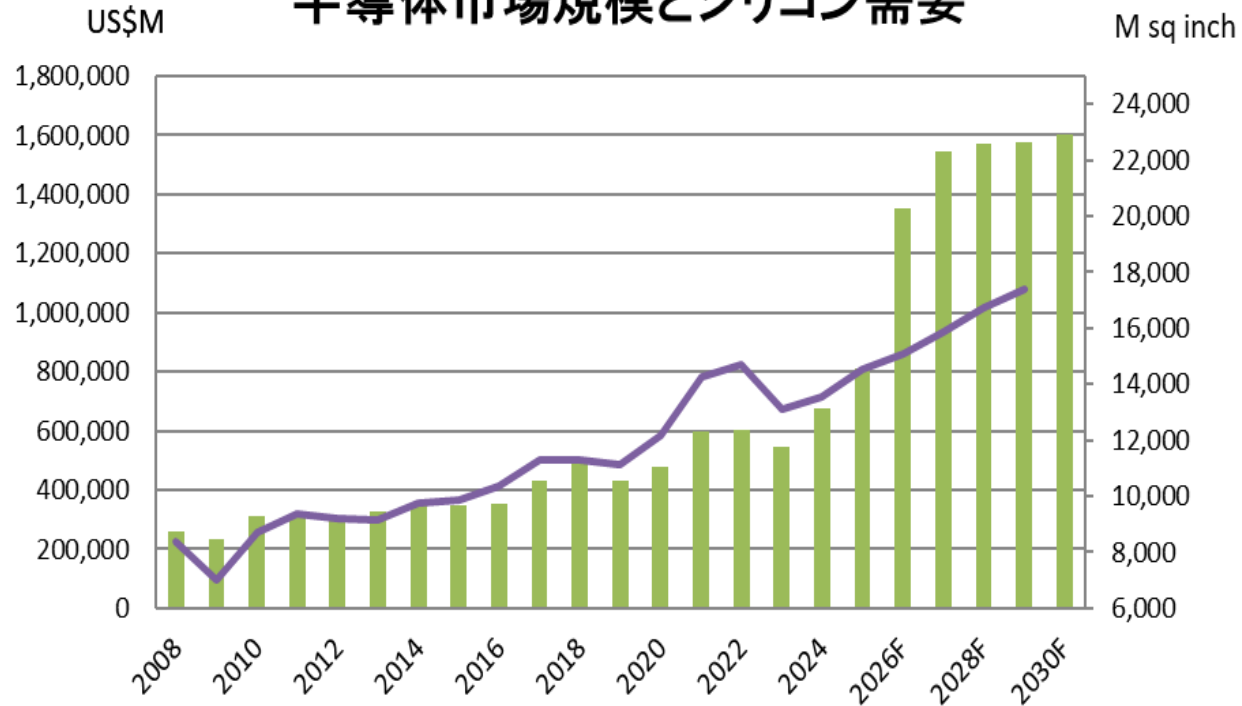
電子機器インパクト
DX：100兆円
GX：700兆円
AI：300兆円

半導体インパクト
DX：20兆円
GX：70兆円
AI：140兆円
年間で約45兆円の半導体
需要となる
SpaceX、TeraFab、Starship
Optimus、Neuralink、Amazon
(Project Kuiper)

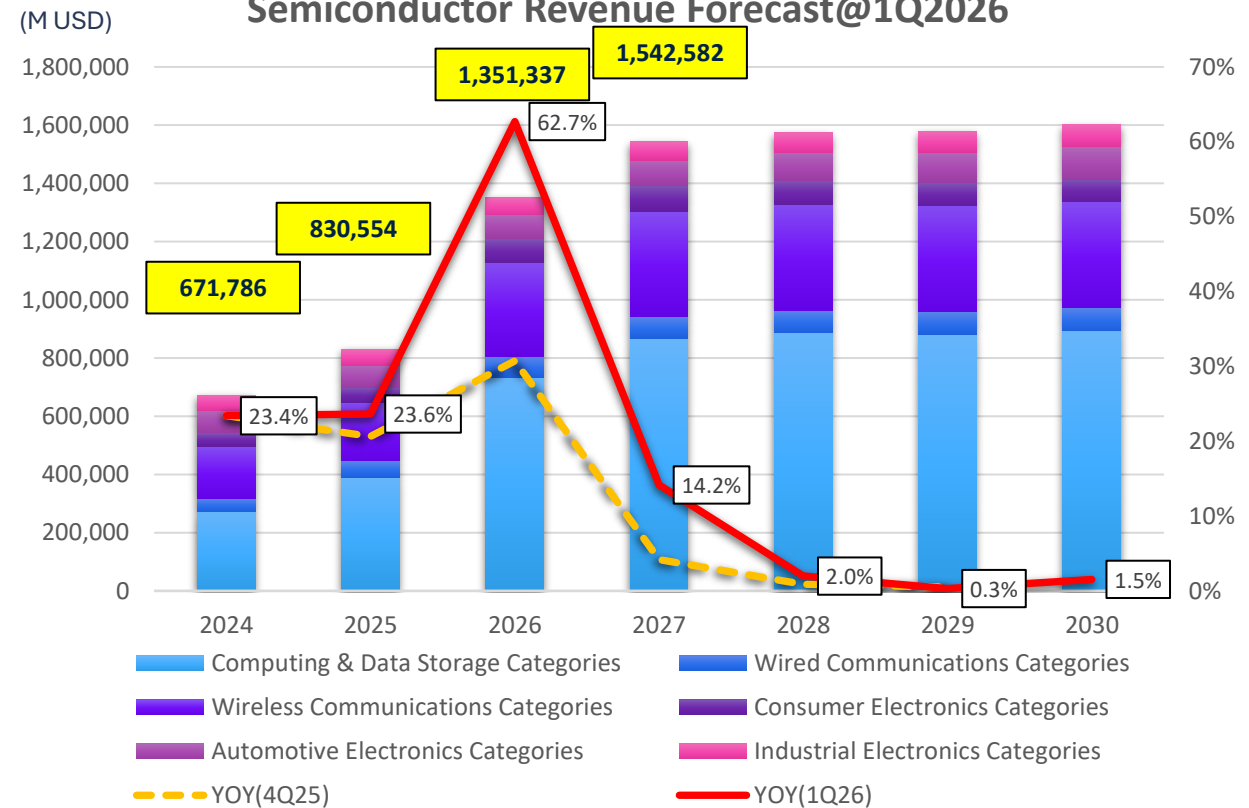
2026年の半導体金額市場は63%増、しかしシリコン需要は5%増

- 半導体は2026年に62.7%成長へ大幅に引き上げられ、市場規模は1.35兆ドルまで拡大する見通し。半導体金額市場で情報機器（AIサーバーを含む）向けがこの2年で急拡大。今後もコンピュータ向けが暫くは50%以上の半導体を消費する
- 金額市場は急拡大しているが数量では5%増であることを認識するべきである。

半導体市場規模とシリコン需要

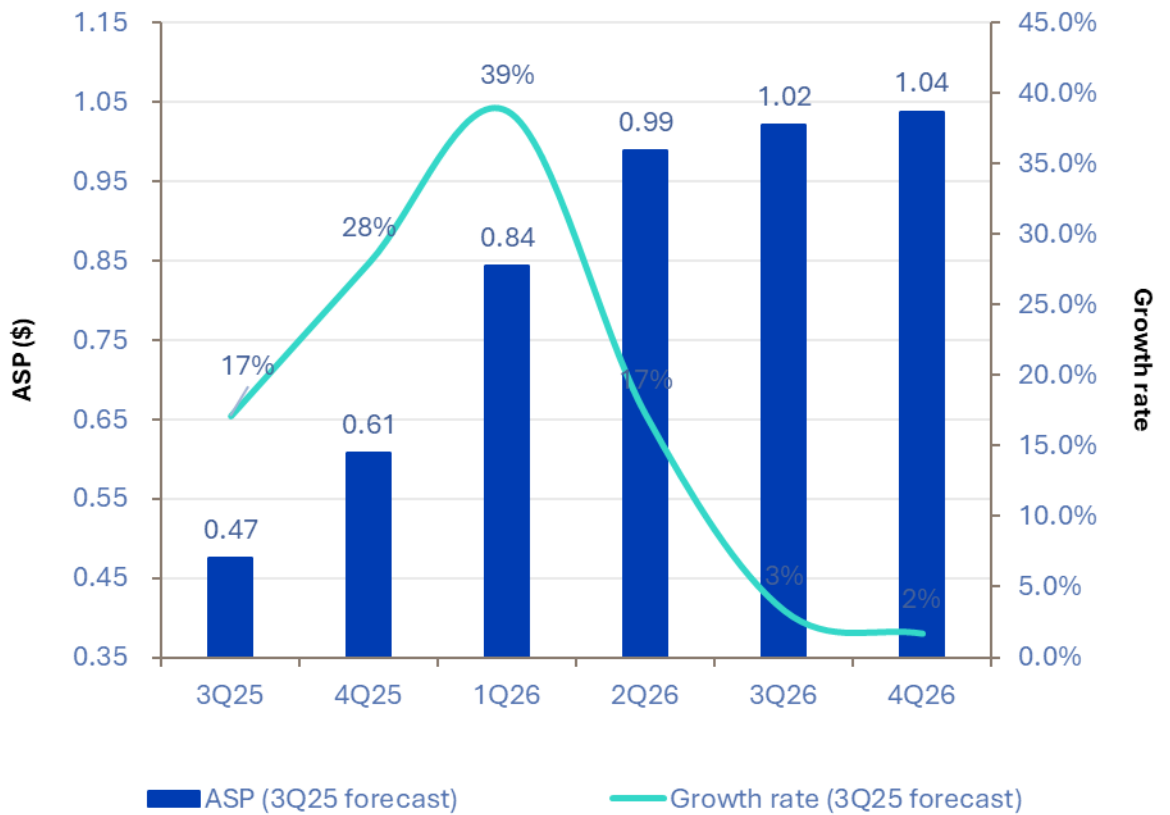


Semiconductor Revenue Forecast@1Q2026



DRAMとNANDの価格推移

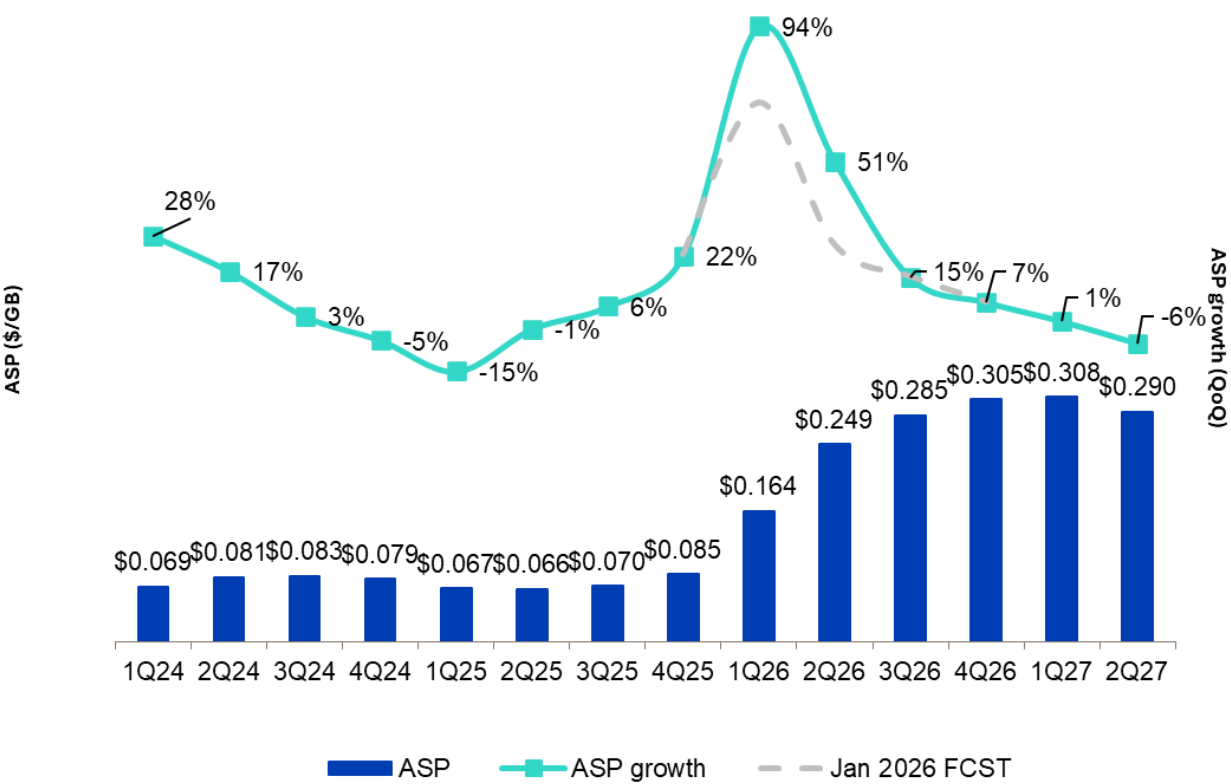
DRAM ASP (US\$, 1Gb eq.)



Source: Omdia

© 2026 Omdia

NAND pricing



Source: Omdia

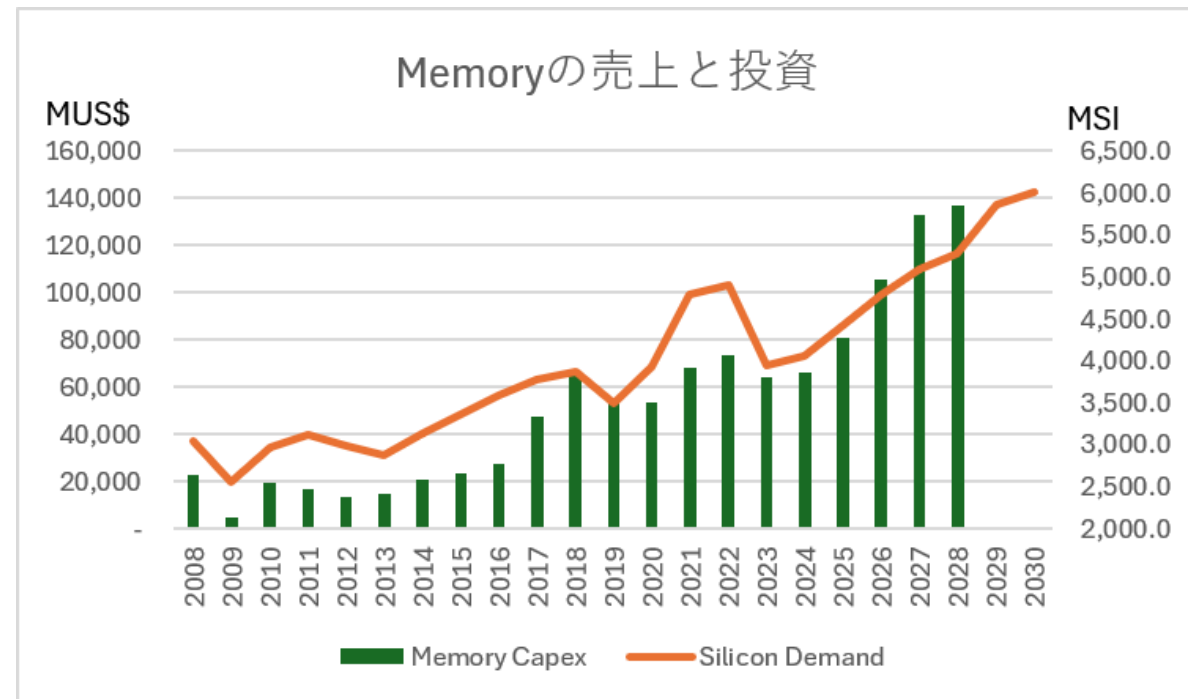
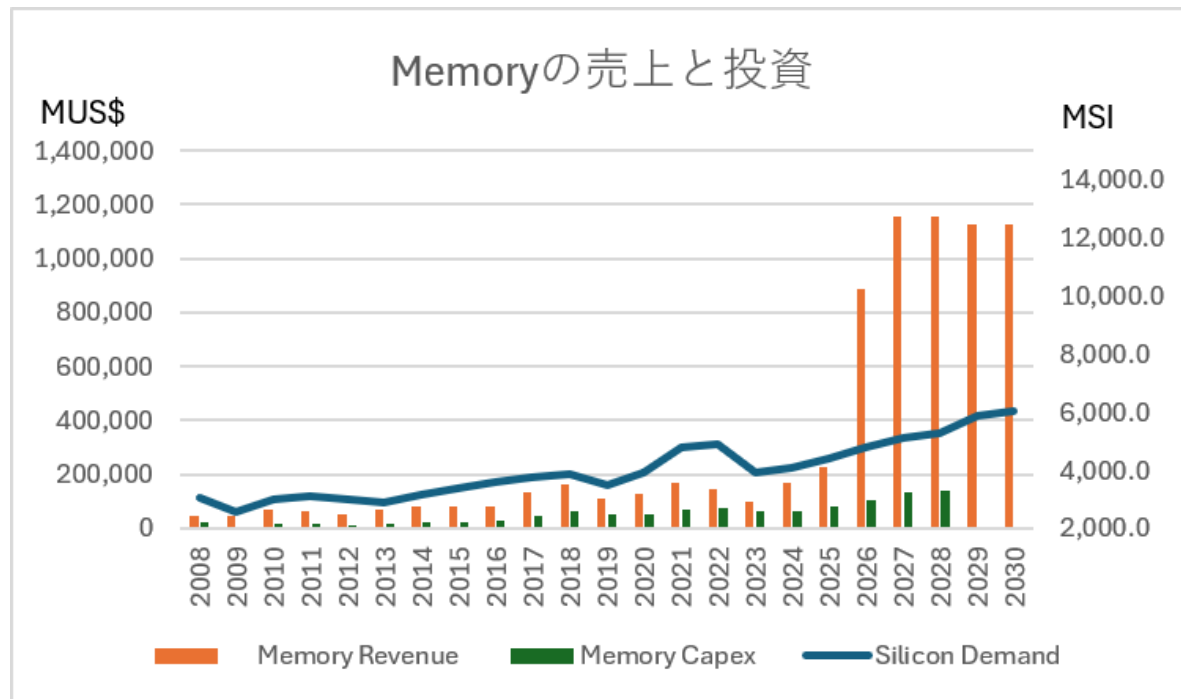
© 2026 Omdia



Memoryの設備投資が適正化検証する

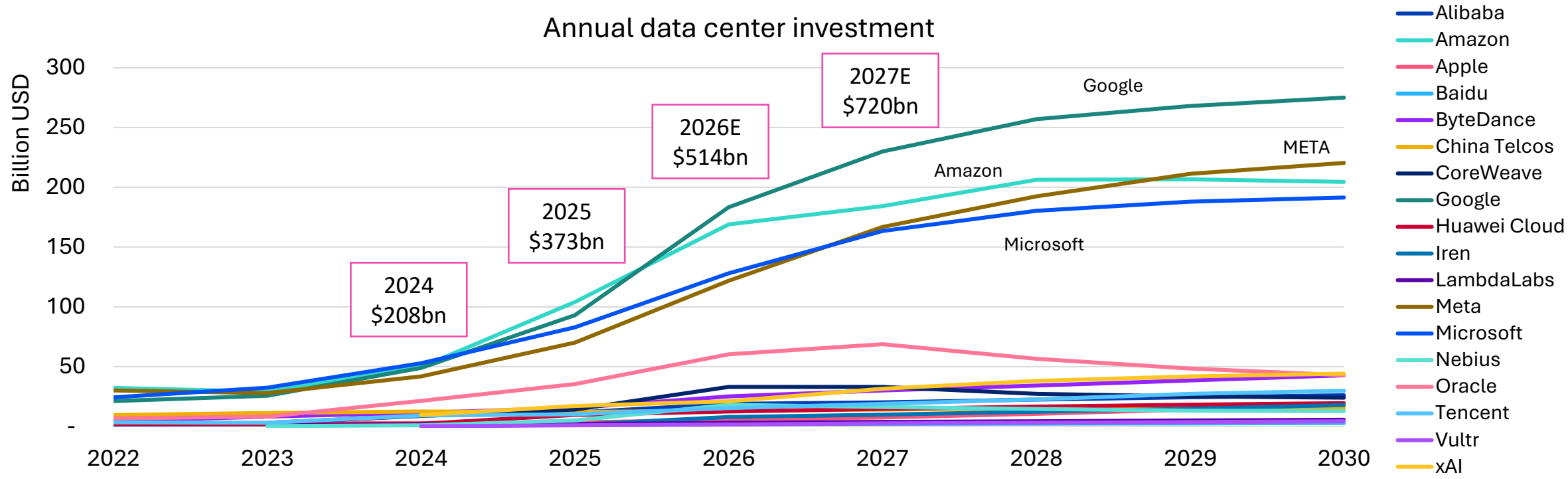
- DRAMとNANDの合計の設備投資が適正であるか検証する
- Memoryの売上が2026年から以上に膨らんでいるが、これは単価上昇が原因
- Silicon Demandをみれば歴然だが、数量ではそこまで急拡大していない

- Memoryの設備投資は2026年以降拡大しておりSilicon Demandを超え始めている
- 2027年以降の設備投資額を抑えないと供給過剰に陥る可能性を示している

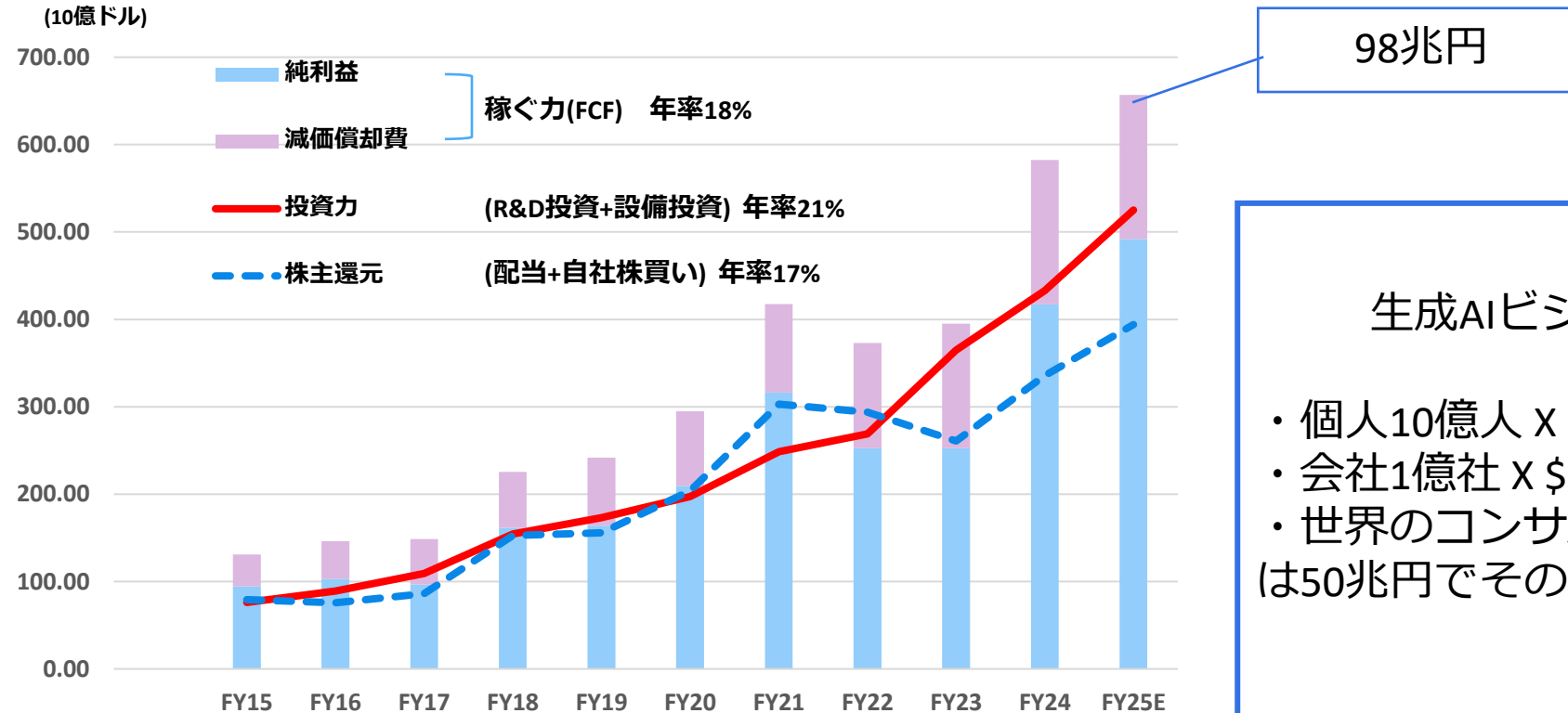


Top CSP(Cloud Service Provider)の投資動向トレンド

- GAFAM 5 社の2025年AIサーバー投資は約50兆円、26年も25%増計画。
- 中国企業は投資が出来ない状況で米国はこの機会を見逃さない。
- 上位12社のサービスプロバイダーは、2025年の世界全体の設備投資（CAPEX）の65%を占めている。
- 対象となる全SPを合計すると、世界全体のデータセンター（DC）設備投資の71%を占める。



GAFAMの収益力、投資力、株主還元力の推移



出所:各社10Kレポート、武者リサーチ

➡AI革命で成長力再加速、収益、株主還元、投資の三位一体の好循環

生成AIをすでに活用している例

生成AIをビジネスに活用する9つの方法

- ①リサーチ・翻訳・要約・分析
- ②企画立案・フィードバック
- ③メール・企画書等の文書作成
- ④設計・デザイン案作成
- ⑤ソフトウェア開発・デバッグ
- ⑥チャットボット等による社内知見の検索・業務支援
- ⑦文書/画像等のコンテンツ作成
- ⑧チャットボット等による顧客対応自動化
- ⑨サービス機能・顧客体験の進化



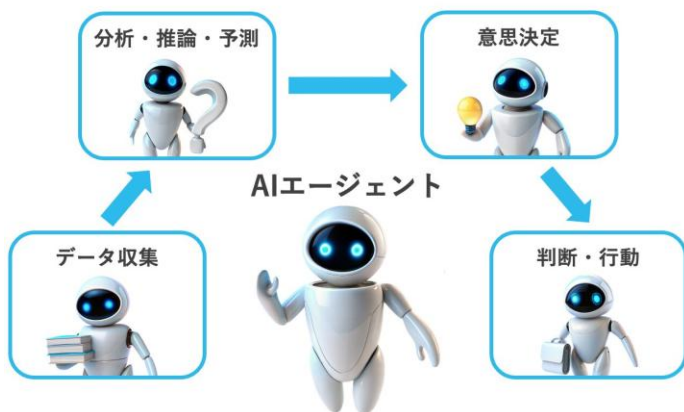
生成AIのビジネス活用事例15選

- ①セブンイレブン：生成AIを活用し商品企画の期間を1/10に
- ②西松建設：生成AIを活用し高精度な建設コストの予測へ
- ③サントリー：生成AIからのアドバイスを活用しユニークなCMを企画
- ④三菱UFJ銀行：生成AIの導入で月22万時間の労働時間の削減へ
- ⑤SMBCグループ：独自の対話AI開発で従業員の生産性向上へ
- ⑥パナソニック：電気シェーバーのモーター設計に生成AIを活用
- ⑦大林組：生成AIがスケッチを基に建物の複数のデザイン案を提案
- ⑧パナソニックコネクツ：AIアシスタントを導入し1日5000回の利用
- ⑨伊藤園：生成AIで作成したモデルをテレビCMに起用
- ⑩パルコ：広告の動画・ナレーション・音楽を全て生成AIで作成
- ⑪ロレアル：AI美容アドバイザーが個人に合った美容法を提案
- ⑫アサヒビール：生成AIを活用し従業員の社内情報検索を効率化
- ⑬メルカリ：AIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案
- ⑭ビズリーチ：生成AIを活用した職務経歴書の作成でスカウト率40%UP
- ⑮ウォルマート：生成AIを活用した高度な商品検索・提案を実現

トークンファクトリーとAIEージェント

学習から推論へ移行することで起こる事

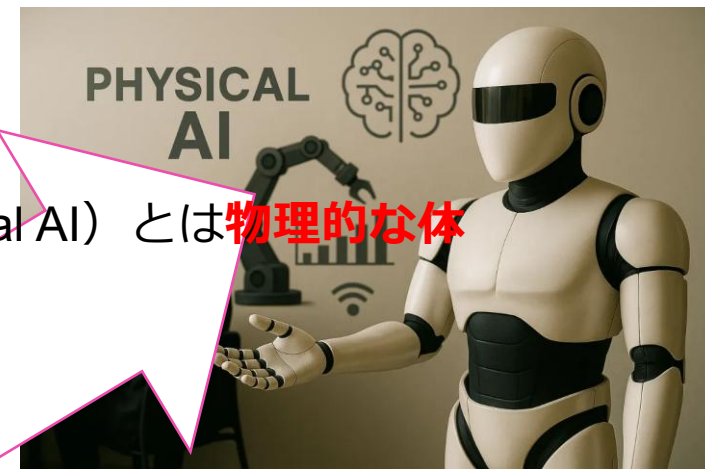
設定された目標に向けて「**自律的に**」行動する



AIEージェントは、人間が細かく指示を出さなくても、**目標を伝えただけで自ら考えて行動し、仕事を完結してくれるAIシステム**のこと

従来のデータセンターは、データを保管する「**倉庫**」で、AIデータセンターは、「**電力**」と「**データ**」を原材料として投入し、「**知能（トークン）**」という製品を大量生産して出荷する「**工場**」

フィジカルAI（Physical AI）とは**物理的な体を持ったAI技術**



それは膨大な計算能力とデータと電力

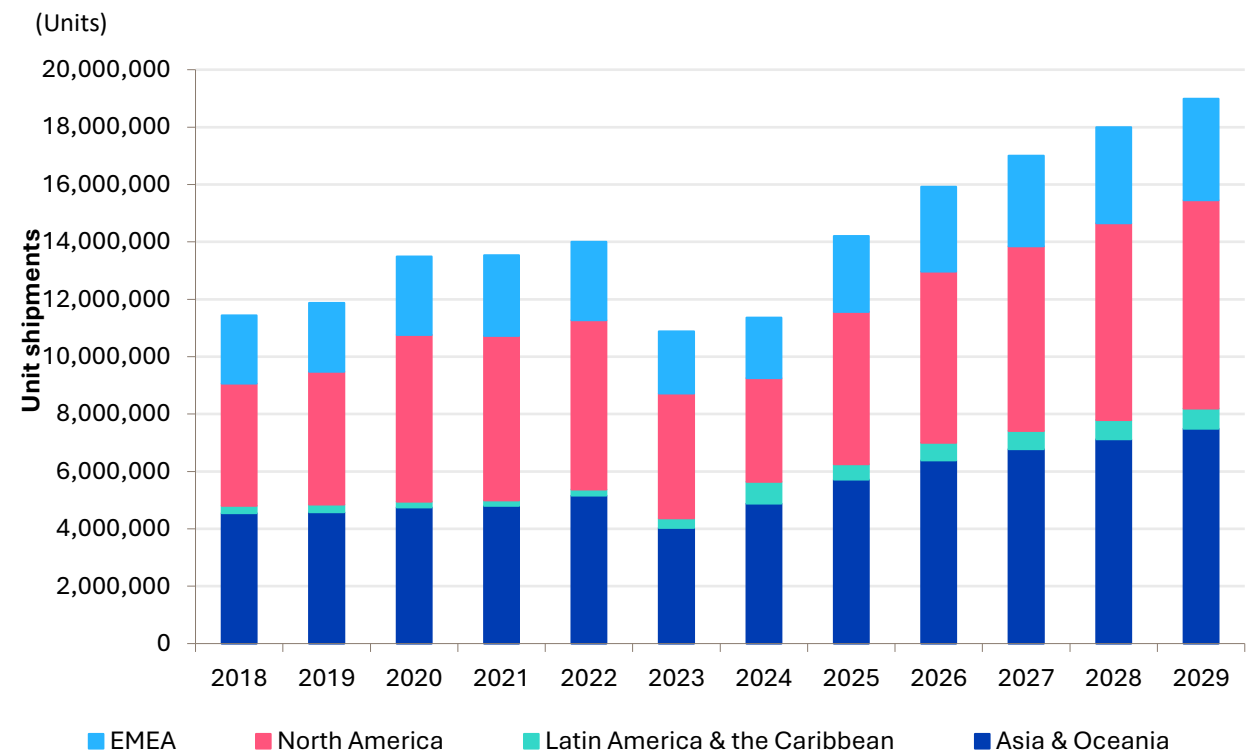


OMDIA

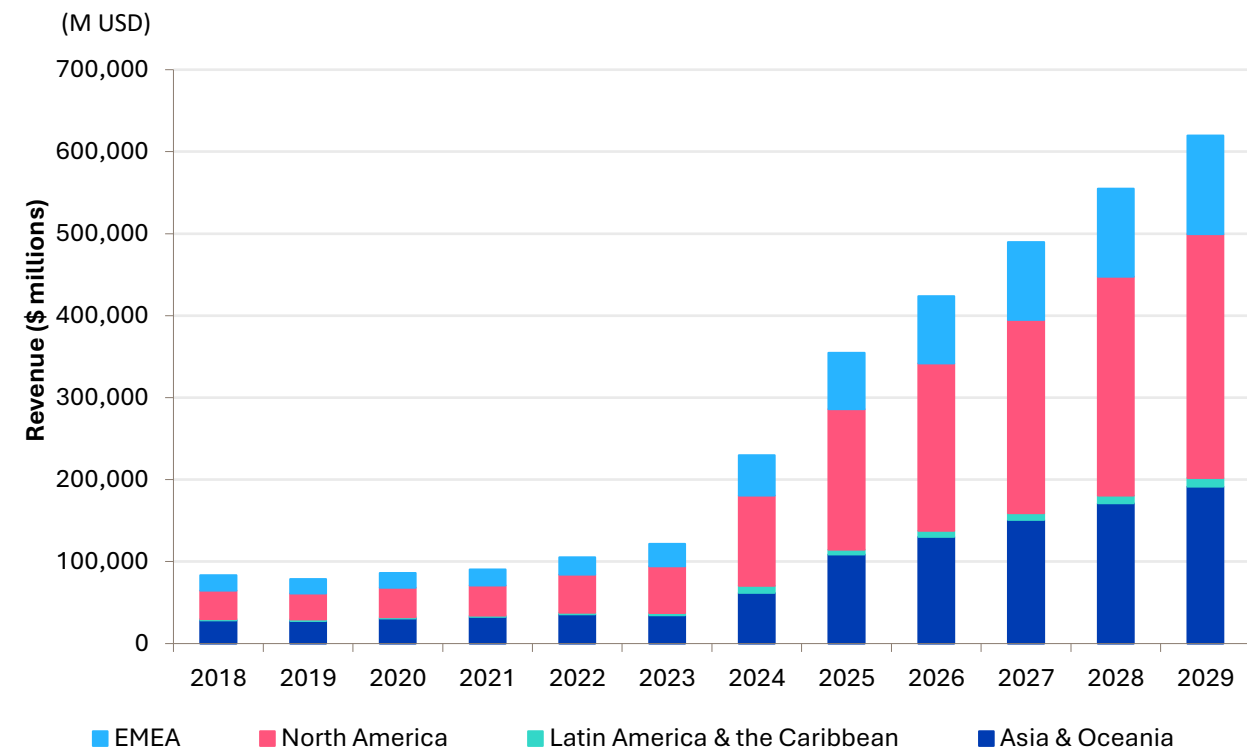
サーバー出荷台数・金額：AI投資の影響によるトレンドの変化

- 2023年下期以降、ハイパースケーラーのAI投資加速からサーバー市場全体の動向に変化が見られる。
- DCサーバーの出荷台数ベースでは2023年に急落し、それ以降はゆるやかな成長となるが、金額ベース成長は2024年以降急激に加速し大幅成長が見込まれる。AIサーバ投資額（搭載される半導体）が汎用サーバに比べて大きいためこのような傾向の変化が出ている。

Servers by region

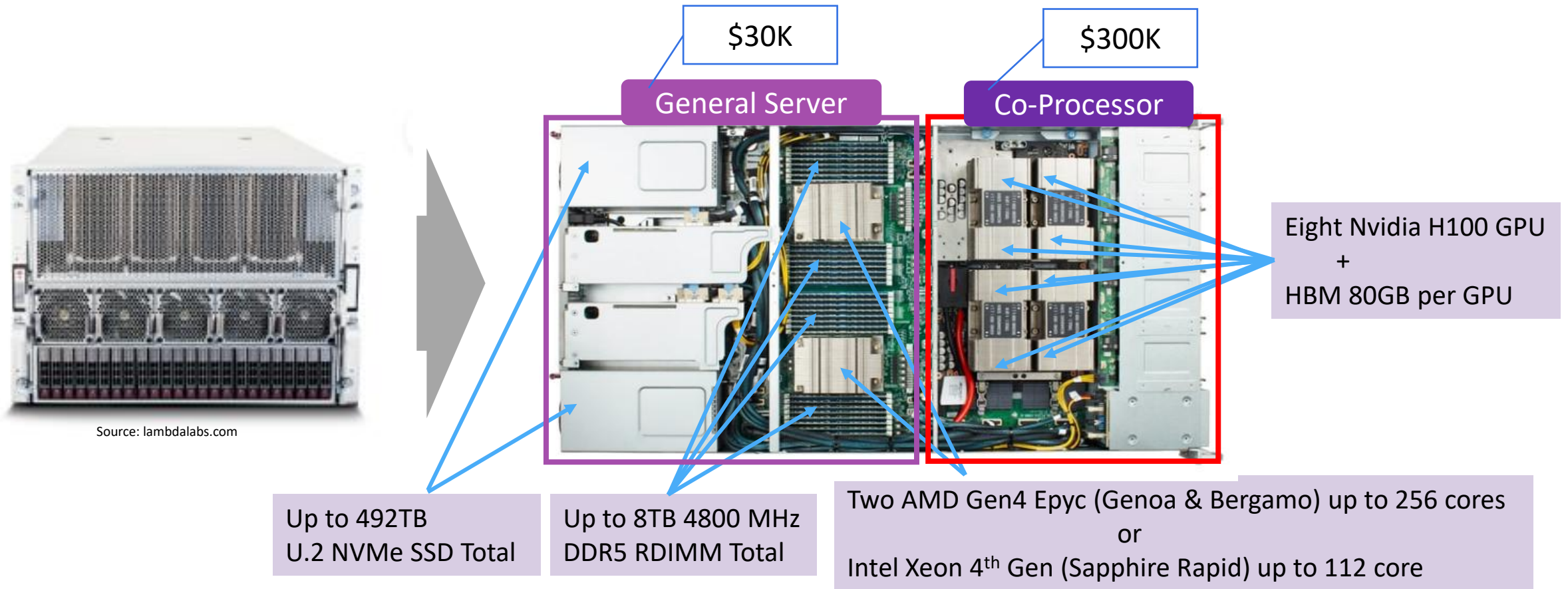


Servers by region



AI Servers Key Components – CPU, GPU, DDR, HBM, SSD

Lambda Hyperplane H100 AI/ML Server (top-down view)



出典: OMDIA

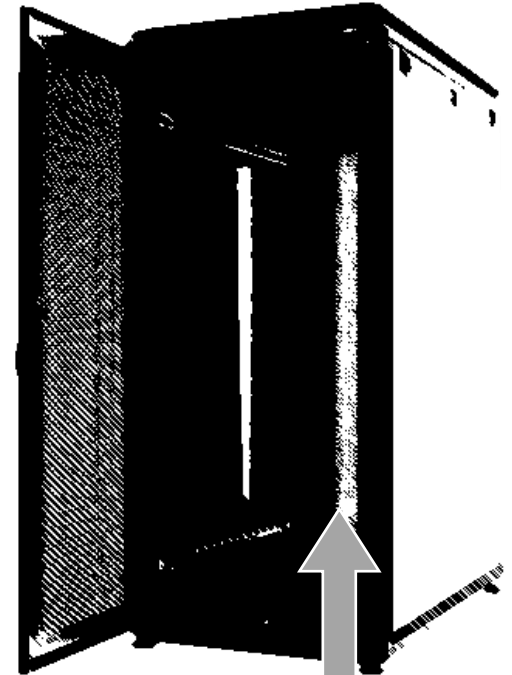


今後のAI Serverの電力予測

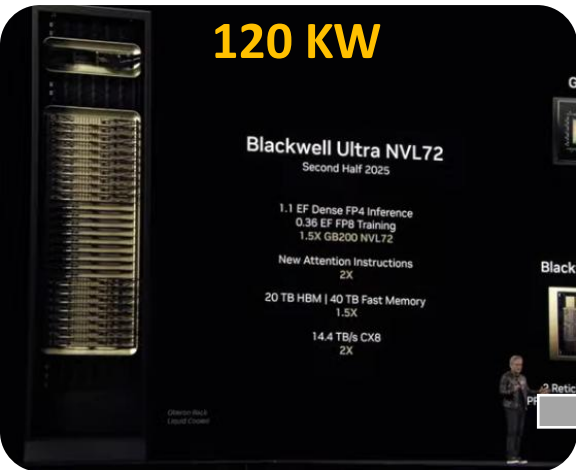
AI Rack density double almost every year

コンピューティングとメモリの需要の増加がラックスケールのシステム設計をリードしていく。

1MW?



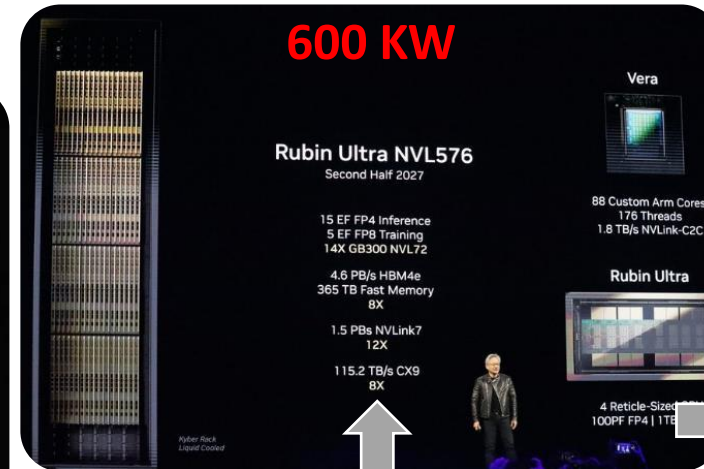
2H 2025
120 KW



2H 2026
240 KW



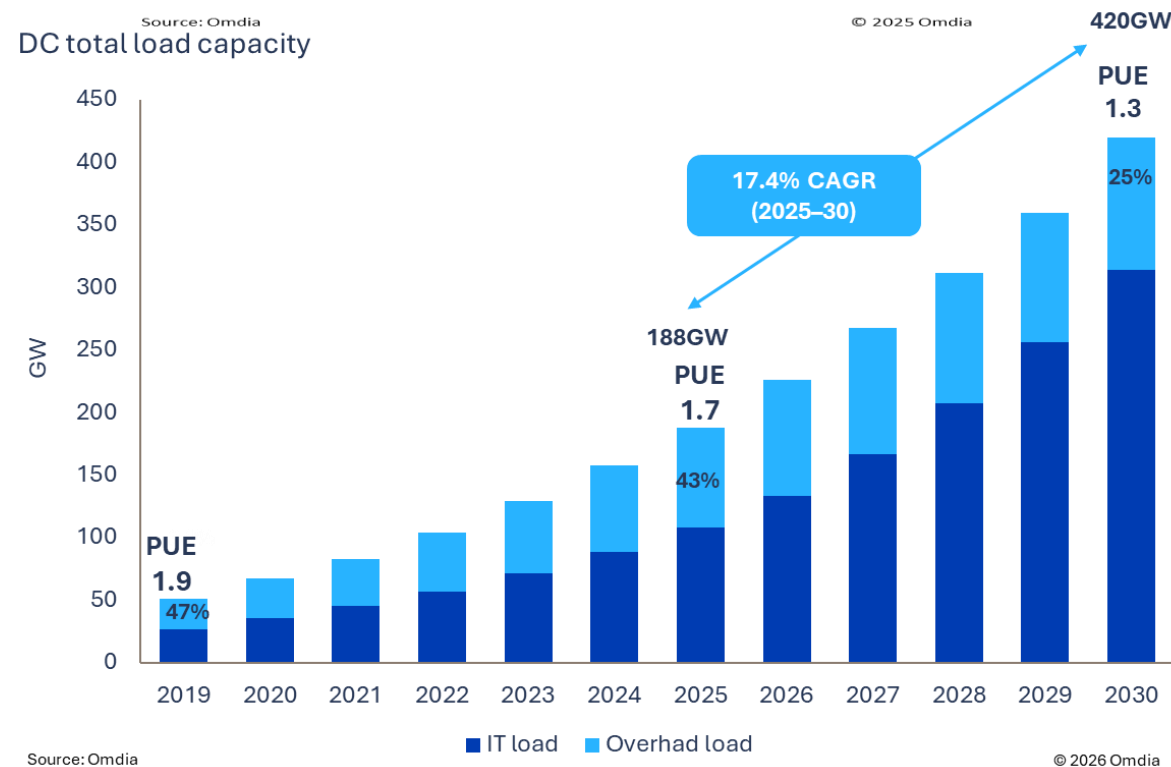
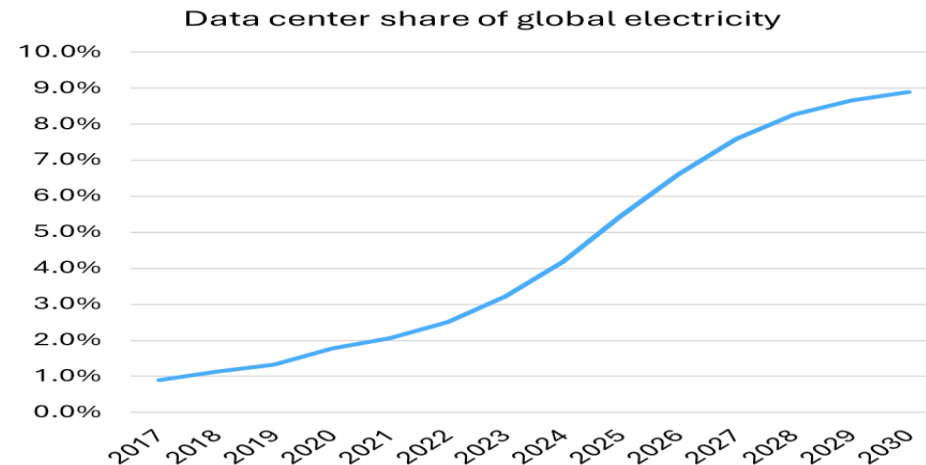
2H 2027
600 KW



1MW/rackの時代に

データセンター：電力問題

- 世界の総電力の約5%がデータセンターに使用されており、2030年に9%に。
- 米国では「100年に一度」とも言える規模で、**電力送配電網（グリッド）の抜本的な再構築**と近代化が進行。送電線の多くは建設から50年以上が経過しており、大規模停電（ブラックアウト）のリスクが高まっている。
- クリーンエネルギーの「詰まり」解消: **地方で発電された太陽光や風力エネルギーを都市部に送るための送電容量が不足しており、多くの再エネプロジェクトが接続待ちの状態。**
- 発電所でつくられた電力が送電・配電のプロセスで失われる割合（送配電損失率）は、平均して約8%~9%**
- データセンター電源の800V（高電圧直流：HVDC）化は、2027年から本格的な導入が始まる計画。電力損失を低減することで**システム全体で約5%~10%の消費電力削減**が見込まれている。
- 空冷式から液浸冷却システムにすることでシステム全体の消費電力が43%削減されたという実証実験がある。**



2030年 420GWのもつ意味



従来型のCPUサーバーは消費電力が300～800W程度でした。GPUサーバーはその10倍以上（1台で約10kW）。この消費電力の爆増が、後述する電源・冷却すべての設計を根本から変えています。

- 参考値 2025年 国別発電量
- 1. 中国 8900-9000TWh
 - 2. 米国 4300-4400TWh
 - 3. インド 1800-2000TWh
 - 4. ロシア 1200 TWh
 - 5. 日本 1000TWh
- * IEA 2025 Report

	現在の基準単位 (1ユニット)	2030年 年間使用電気量 バ予測
必要な電力容量	1 GW	420 GW
年間エネルギー消費	8.76 TWh	3,679 TWh
相当する物理インフラ	原発 1基 / 新幹線 100両	原発 420基分 / 新幹線 42,000両 同時加速分

AIデータセンターの冷却システムが変化している

1. 空冷から水冷へ

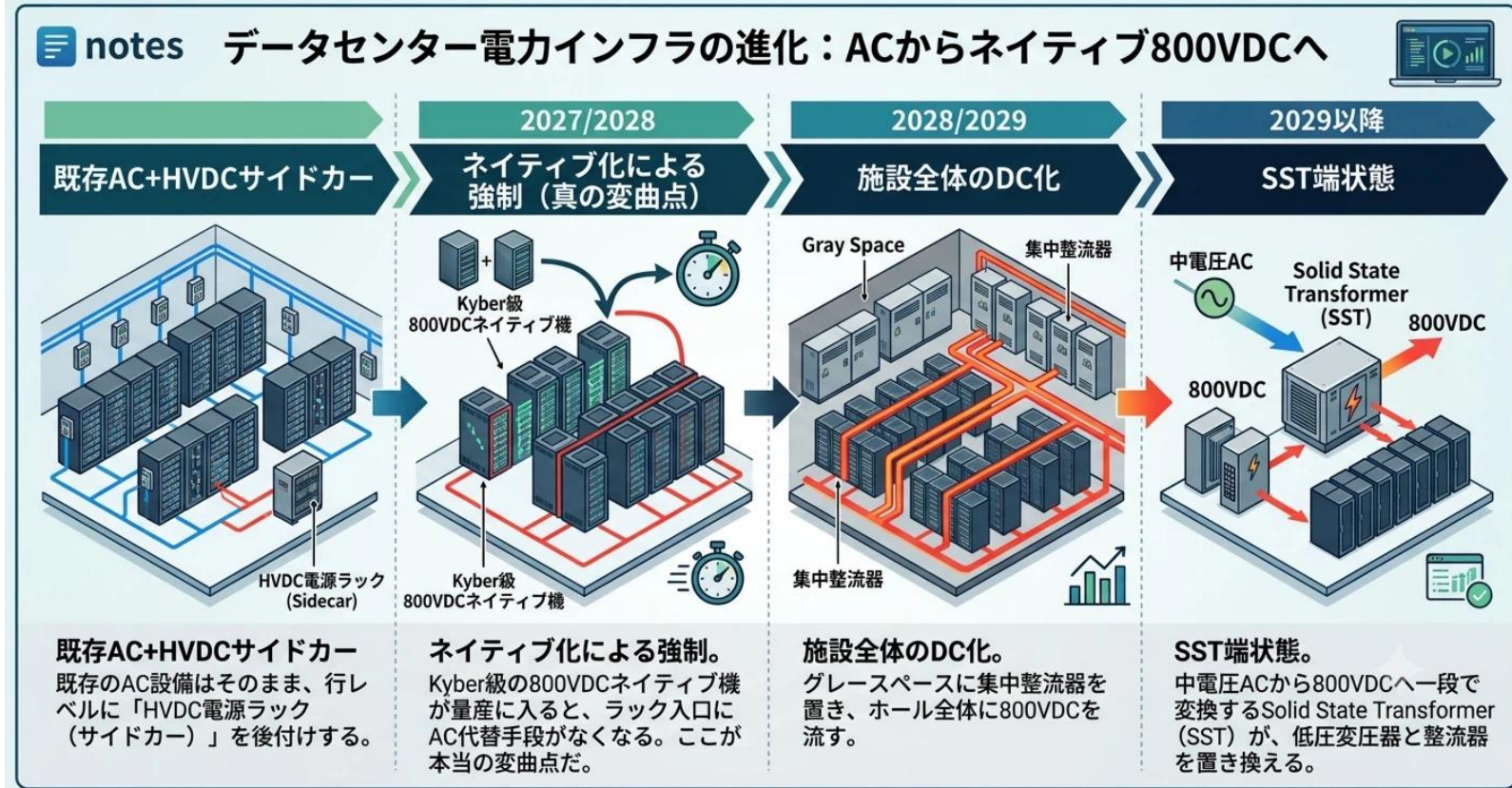
従来型の空冷（ファンで風を送る方式）では、AI半導体が発する熱の処理が物理的な限界に達しています。

AI冷却の主役は、冷却液をサーバー内部まで循環させるDirect-to-Chip（D2C）、またはコールドプレート方式になります。

さらに先を見据えた技術として、サーバーボード全体を電気を通さない特殊な液体（オイルやフッ素系液体）に丸ごとドブ漬けにする浸漬冷却

（Immersion Cooling）の導入が進んでいます。

HBMなどの3D積層半導体では、チップが重なるため内部に熱がこもります。これに対し、チップの内部に微細な液体の通り道（マイクロチャネル）を作り、パッケージの中から冷やす超高精度な技術開発が進んでいます。



AIデータセンターの電源が変化している

1. サーバラック内給電の高電圧直流（dc）化

従来のDCは、AC（交流）400V～480Vでラックまで配電し、内部で12Vに変圧してチップに供給するのが一般的。

600kW級ラック（Vera Rubin Ultra相当）を従来の48～54Vで給電すると、電流は1万Aを優に超える。これを800Vにすると約750Aとなり電流はおよそ15分の1、同じ導体なら抵抗発熱は200倍以上下がる計算になる。NVIDIAも800VDCなら同じ銅で150%以上の電力を送れ、1ラックあたり200kgの銅バスバーが不要になると説明している。

800VDC（NVIDIA仕様）や±400VDC（OCP仕様）で給電されても、ラック内部のバスバーは依然50Vで分配される。ラック内のDC-DC電源シェルフが高電圧DCを50Vへ降圧し、そこからGPUトレイへ供給する。最終的にGPUボード上のVRMが50Vからサブ1Vへ落とす。

800VDC構成では集中型の低圧UPSは役割を失い、最終的に陳腐化する見込みだ。代わって電源ラック内にBBU（バッテリーバックアップ）とスーパーキャパシタが載る。両者とも直にDC結合され、AC-DC-ACの二重変換損（2～3%）を避けられる。GoogleとMetaは既に数年前から、集中UPSをバイパスしてラックレベルのLi-ion BBUで短時間ブリッジを取る分散UPSを実践している。

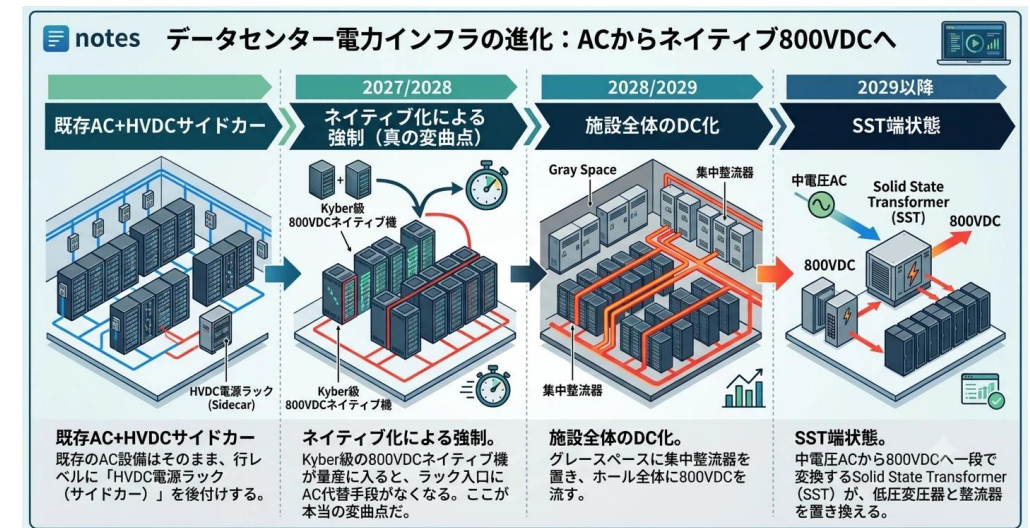
見落とされがちだが、冷却系は依然ACが残る。チラーポンプファンはACモータ駆動で、DC-AC逆変換器を要する。DeltaはGTC 2026で800VDC対応の2.4MW In-Row CDUを出したが、DCネイティブな冷却システム一式を売るベンダはまだ存在しない。

2. パワー半導体の主役がGaNへ

AIサーバーのPSU（電源ユニット）や、チップの直近で電圧を下げるDC/DCコンバーターには、これまでシリコン製のパワー半導体が使われてきた。しかし、AIの急激な負荷変動と高密度化に対応するため、新素材へのシフトが急速に進んでいます。

GaN（窒化ガリウム）の独壇場へ：GaNはシリコンに比べて超高速でスイッチングができ、エネルギー損失が劇的に少ないのが特徴です。

電源の小型・高密度化：GaNを採用することで、従来の1/8という超小型でありながら1kWを超えるような、超高電力密度のDC/DCコンバーターが実用化されています。



AIデータセンターの電源が変化している

3. チップ直近でのオンボード / 垂直給電 (VPD)

GPUそのものの消費電力が1基あたり1,000Wを超える中、チップの真下から電力を供給する技術が必須となっています。
垂直給電 (Vertical Power Delivery) : マザーボードの横から配線を通すのではなく、GPUチップの裏面から垂直に給電する構造が注目。
配線距離が数ミリメートル単位まで短縮されるため、電圧降下やノイズ、マザーボード上での熱発生を抑え、高パフォーマンスを維持できる。

4. 送電網 (グリッド) との直結と、独自のクリーン電源確保

AIデータセンターの消費電力が大きいことから、地域の送電網 (グリッド) から電力を引っ張るだけでは間に合わなくなっている。
直流グリッド (DC Grid) の構築 : 2028年以降には、データセンターが太陽光発電や大規模蓄電施設と直流のまま直接電力をやり取りする直流グリッドの構成が本格化します。
原子力 (SMR) や専用クリーン電源の確保 : Microsoft、Amazon、Googleなどは、24時間安定して大電力を供給できる次世代小型モジュール炉 (SMR) を含む原子力発電や、蓄電池ベンダーとの直接契約を進めており、電源の地産地消化が始まっています。

5. 大型UPSは衰退するが小型UPSが残る

AIの大規模言語モデル (LLM) などの学習では、万が一電源が落ちても、直前の計算状態から再開できるチェックポイントが定期的に保存されている。そのため、一般的なWebサービスのようには、1秒のシステム停止も許されないという性質とは異なるため、過剰なバックアップは不要であると言われている。
よってデータセンター全体を1つの巨大なUPSで守る従来の方式から、サーバーラックごとに小型のバッテリー (ESSなど) を組み込む分散型 (DCバス直接連結) アーキテクチャへの移行が進んでいます。これが、従来のUPS装置がいらなくなるという誤解を生む一因となっています。

AIの計算 (特に推論や学習のバースト時) が始まると、一瞬で莫大な電流が流れます。逆に計算が終わると急激に下がります。この数十ヘルツ単位で発生する極端な電力変動は、地域の電力系統 (グリッド) を不安定にさせるため、Tesla Megapackに代表されるような超高速応答の大型バッテリーシステムや新型UPSがバッファとして電力を吸収・補填する役割を担っています。
従来のデータセンターは1ラックあたり数kW~8kW程度でしたが、NVIDIAの最新GPU (Blackwellなど) を搭載したAIラックは1ラックあたり30kW~100kW以上の電力を要求します。この超高密度な電力を安定して質の良い直流 (DC) 電気として流し続けるために、インフラ側の配電装置やUPSのアップグレードが必須となっています。

サーバに使用されるパワー半導体 - LFT からSSTへ

電力損失を30%-70%削減とみられ、UPS機能を内蔵するなど、システムの簡略化もはかれる。
2028年ころをめどに導入が進むとみられている。* Infineon様資料より

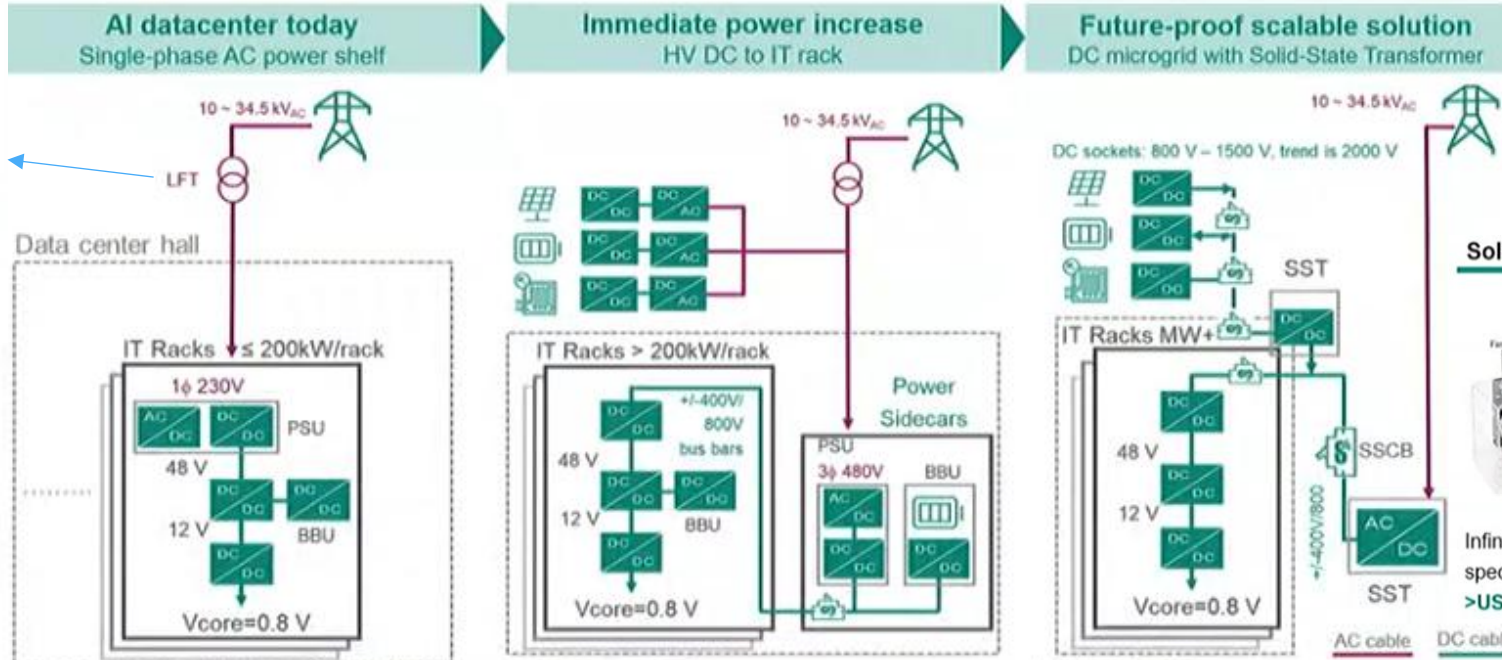
インフィニオンはあらゆる電源電圧をVcoreに変換

Conventional Transformer



Conventional transformer market
>USD 15bn

Low Frequency Transformer



*these are exemplary schematics of key power conversion stages for power delivery to IT racks

LFT = Line Frequency Transformer
SSCB = Solid State Circuit Breaker

PSU = Power Supply Unit
BBU = Battery Backup Unit
SST = Solid-State Transformer

Copyright © Infineon Technologies AG 2020. All rights reserved.



Solid-State-Transformer (SST)



Infineon expects that SST will replace a portion of the market, specifically small power transformer with an expected market of >USD 1bn in 2030

AIデータセンターのMLCC搭載数が増えている

AIサーバーでは、従来の一般的なサーバーと比べて、使用される電子部品の数が約10倍～15倍に急増します。

1. 積層セラミックコンデンサ（MLCC）搭載数10倍

従来のサーバーが数千個だったのに対し、AIサーバーでは1万～3万個へと跳ね上がります。ラック単位: 複数のサーバーを収めるAIサーバーラック（例：NVIDIAのNVL72など）全体では、実に44万個以上のMLCCが消費されます。

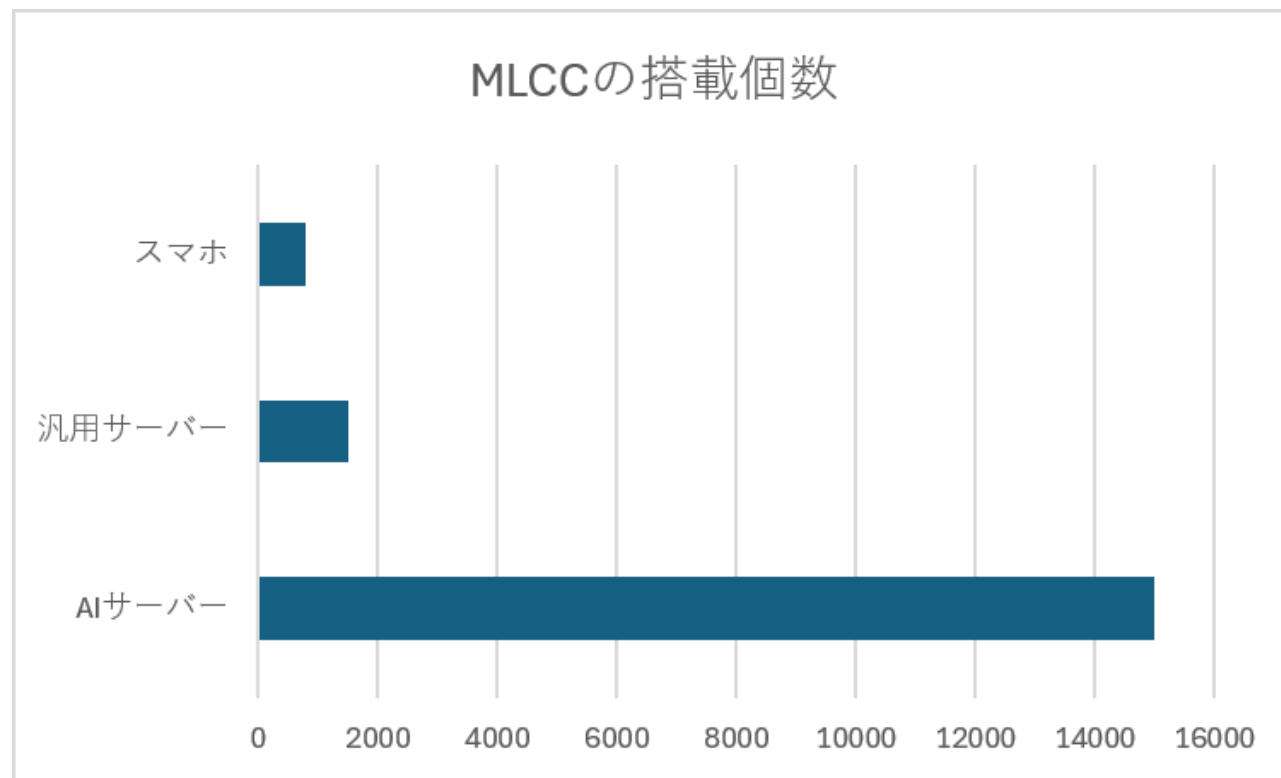
理由: 1200Wを超えるような超高電力GPUを安定して動かすため、電圧の乱れ（ノイズ）を抑え、電気の流れを整える役割が大量に必要なためです。

2. プリント基板（PCB）のレイヤー数増加

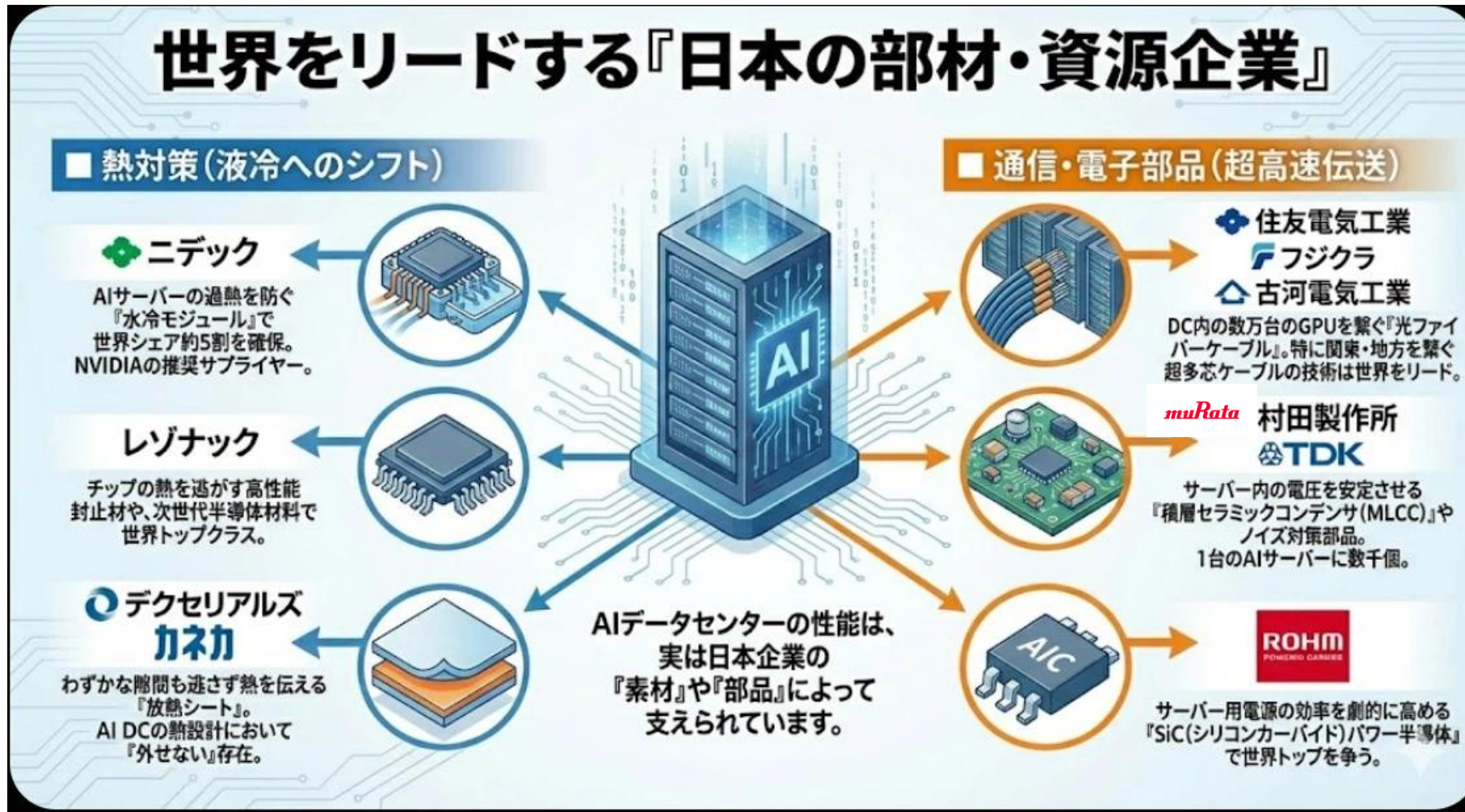
通常のサーバー基板が約12層構造であるのに対し、AIサーバー用は20層～30層以上の超多層基板になります。

部品の密集度と製造難易度が極めて高くなるため、基板1枚あたりの価値は通常の5～6倍に跳ね上がります。

GPU、CPU、そして超高速メモリ（HBM）の間を、膨大な量の配線で超高速かつノイズなく繋ぐ必要があるためです。

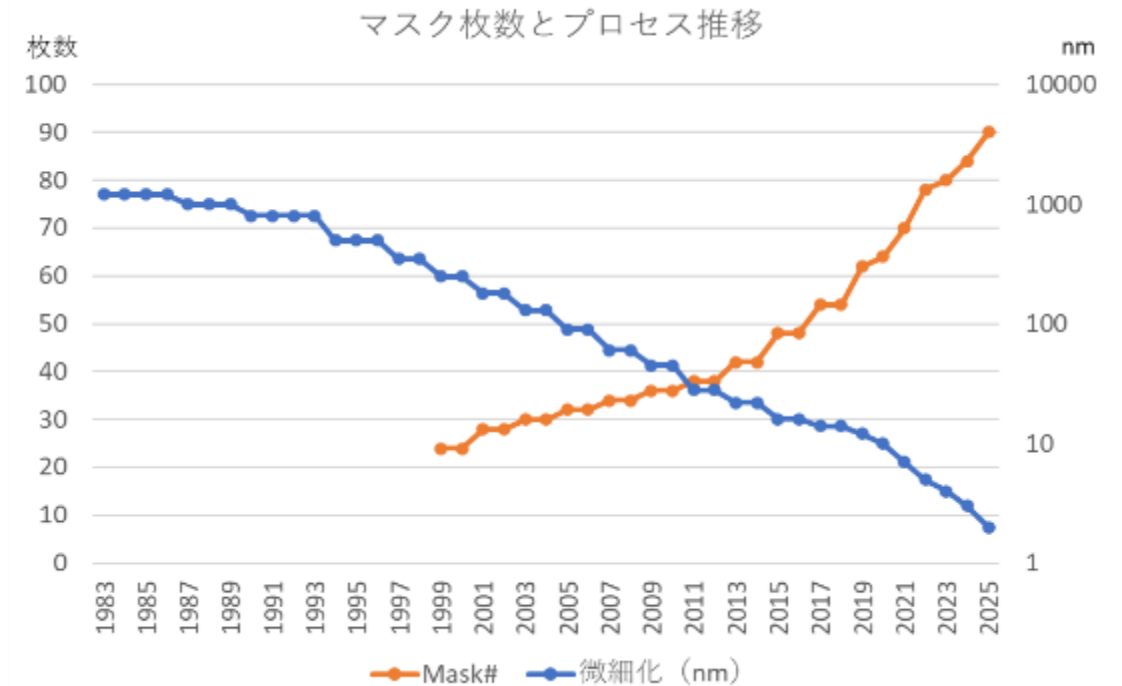
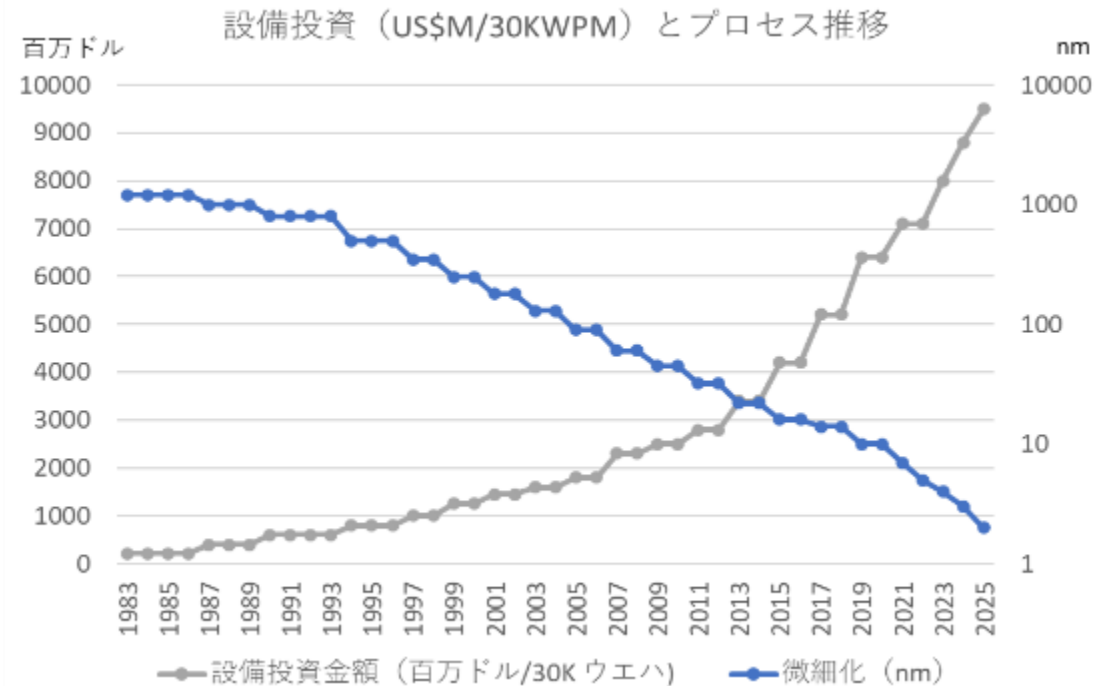


AIデータセンター内で日系企業の存在感が高まっている

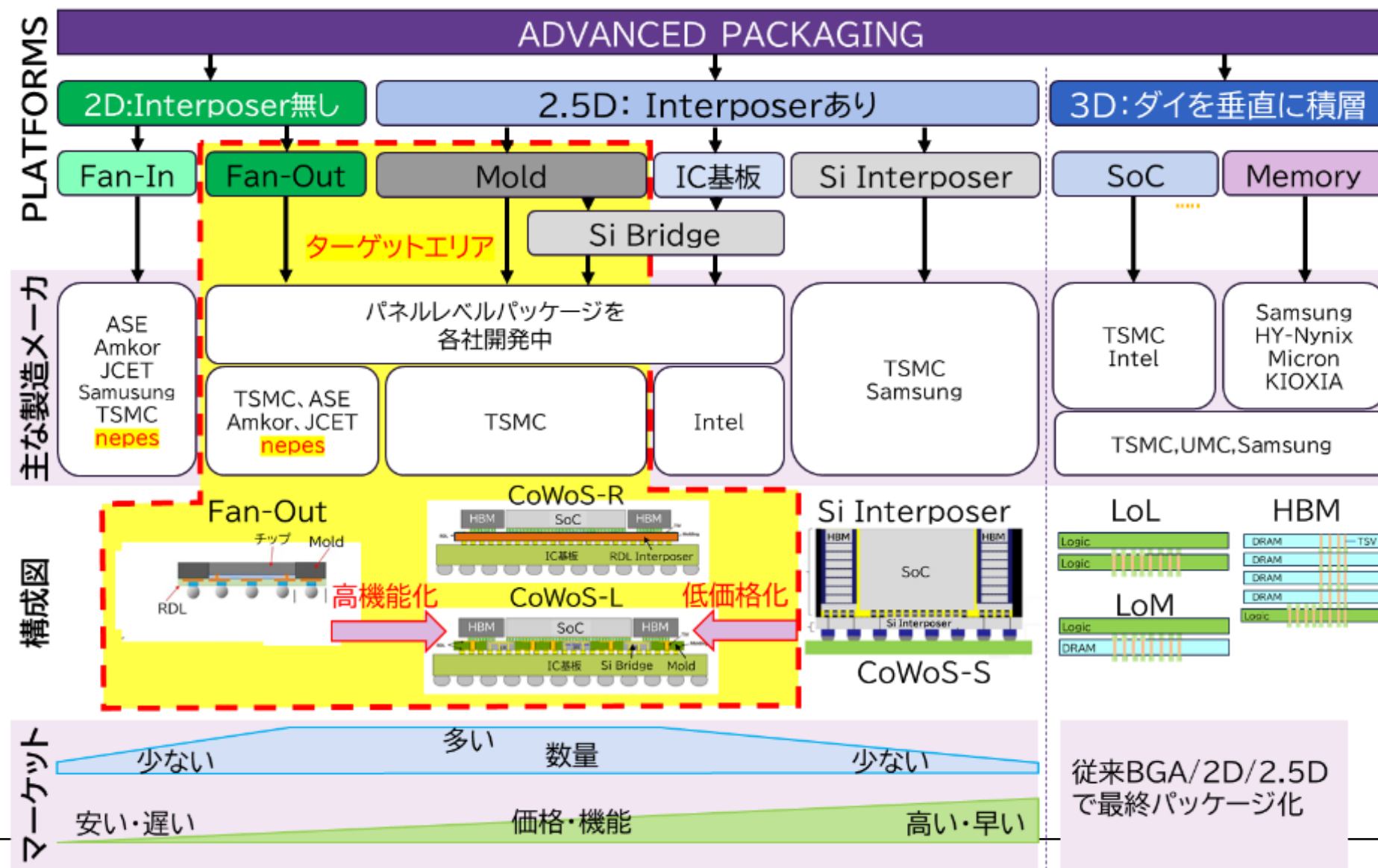


半導体投資増とプロセス、マスク枚数増で微細化が経済的に厳しくなっている

- 左図：設備投資金額（US\$/30K Wafer per month）とプロセスノードの推移を示している。2013年頃から投資金額の増加が顕著になり、微細化に伴い設備投資金額が膨大になっている。これは設備単価が上昇している事、マスク枚数増加で実質キャパシティの上昇が鈍化しているため。例えばNANDは2Dから3D積層構造になり前工程処理日数が2か月から4か月に倍増したため、実質キャパが半減した。
- 右図：マスク枚数とプロセスノードの推移を示している。プロセスが進化すればするほどマスク枚数は増加しており、2013年以降の増加率が高くなっている事が左図の投資金額増加の要因となっている事が理解できる。



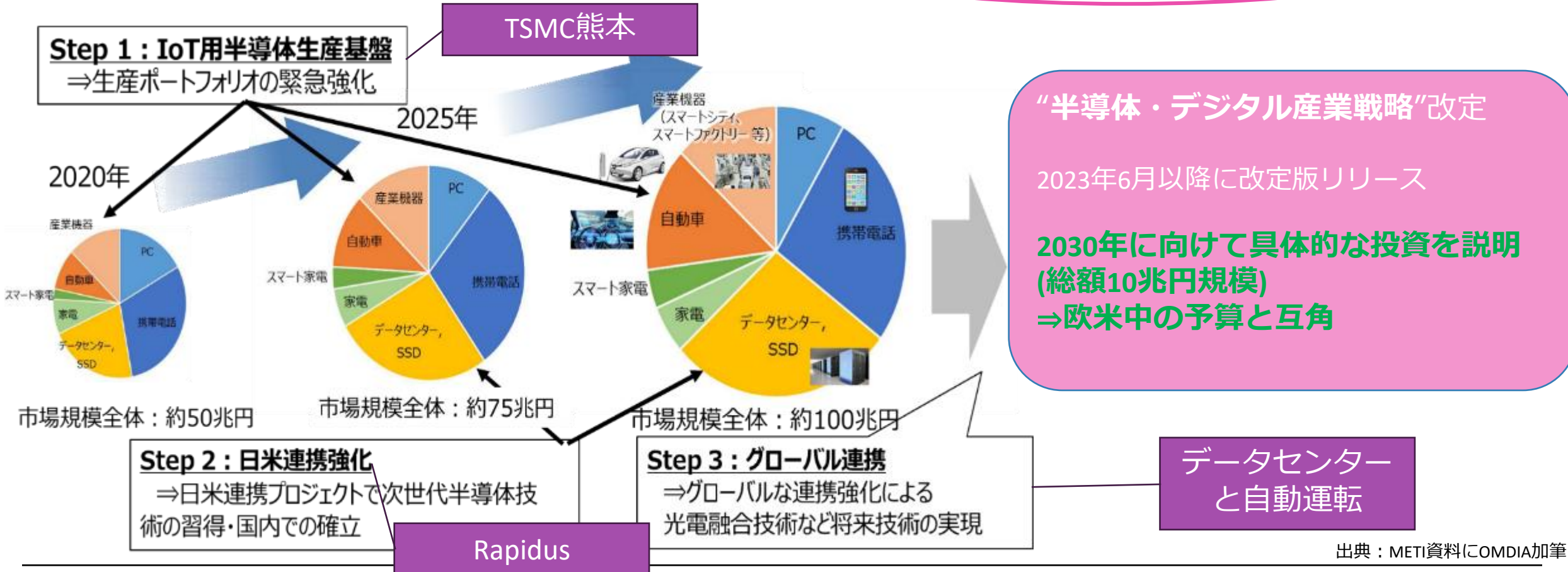
ADVANCED PACKAGING PLATFORMS



半導体支援概要について

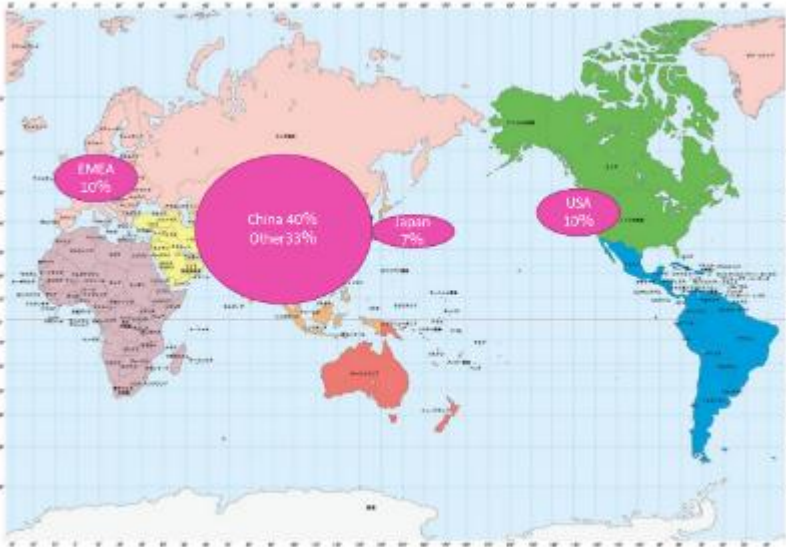
- IoT用半導体生産基盤の緊急強化 (Step: 1)
- 日米連携による次世代半導体技術基盤 (Step: 2)
- グローバル連携による将来技術基盤 (Step: 3)

米国は日本を新たなサプライチェーン構築のための最も重要なパートナーとした

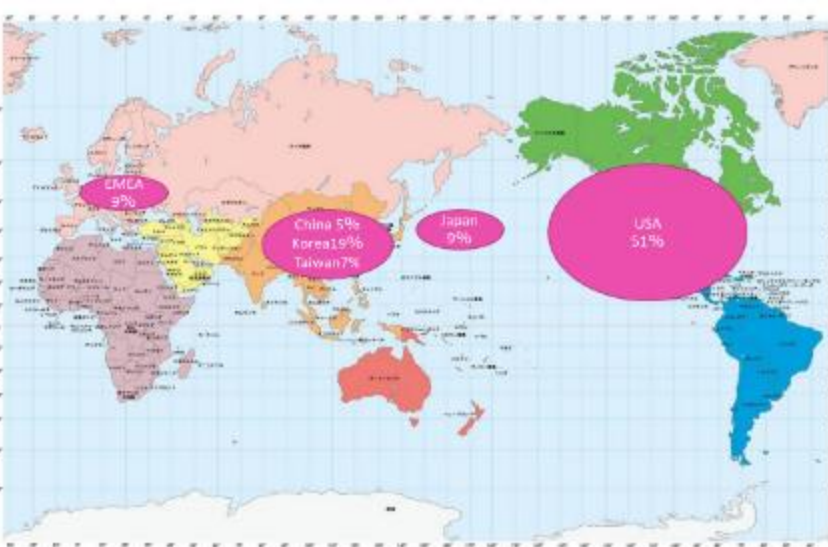


出典：METI資料にOMDIA加筆

半導体需要動向



半導体供給動向



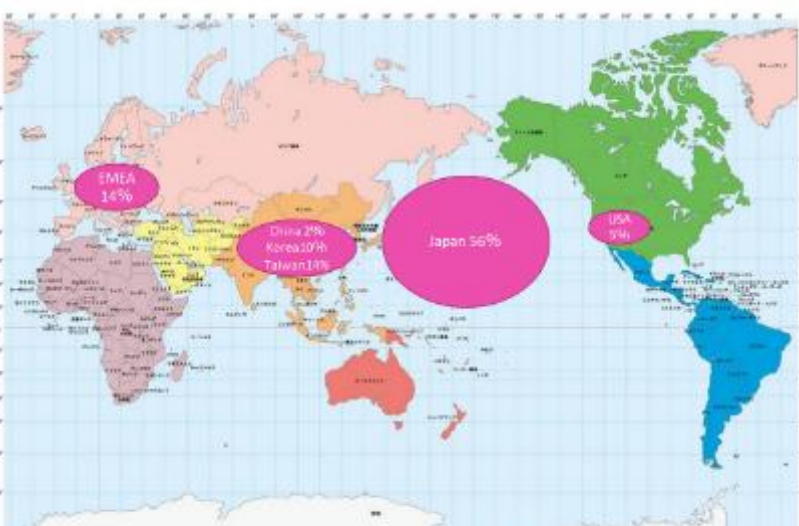
半導体生産能力動向



半導体装置メーカ一動向



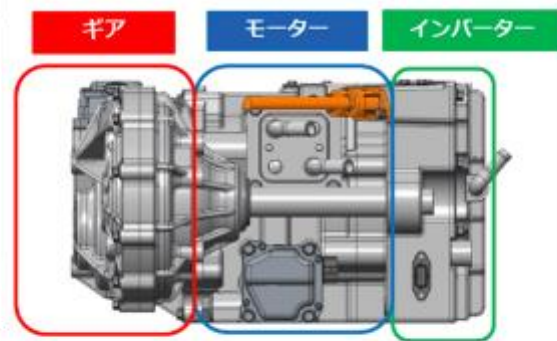
半導体材料市場動向



出典：OMDIA



多くの電子機器は半導体 + 電子部品 + コネクタ + 電池 + モーター + 基板で構成 それぞれはバラバラに製造され組み立てられているだけ



政府指定の「特定重要物資」分野案	
経済産業省	半導体 追加候補：先端電子部品（コンデンサ・高周波フィルタ）
	クラウド
	蓄電池
	永久磁石
	工作機械・産業用ロボット
	航空機部素材
	重要鉱物
国土交通省（船舶関連）	液化天然ガス（LNG）
	船舶機関（エンジン）、プロペラ、航海用機器（ソナー）
厚生労働省	抗菌薬
農林水産省	肥料原料

出典：METI



モジュール化
LEGO化

半導体
+
電子部品
+
モーター
+
コネクタ
+
基板
+
電池
+
ディスプレイ

半導体産業育成は各国で行っている
↓
電子部品やモーターを半導体と融合して
Chiplet 2.0として推進
↓
日本独自の戦略

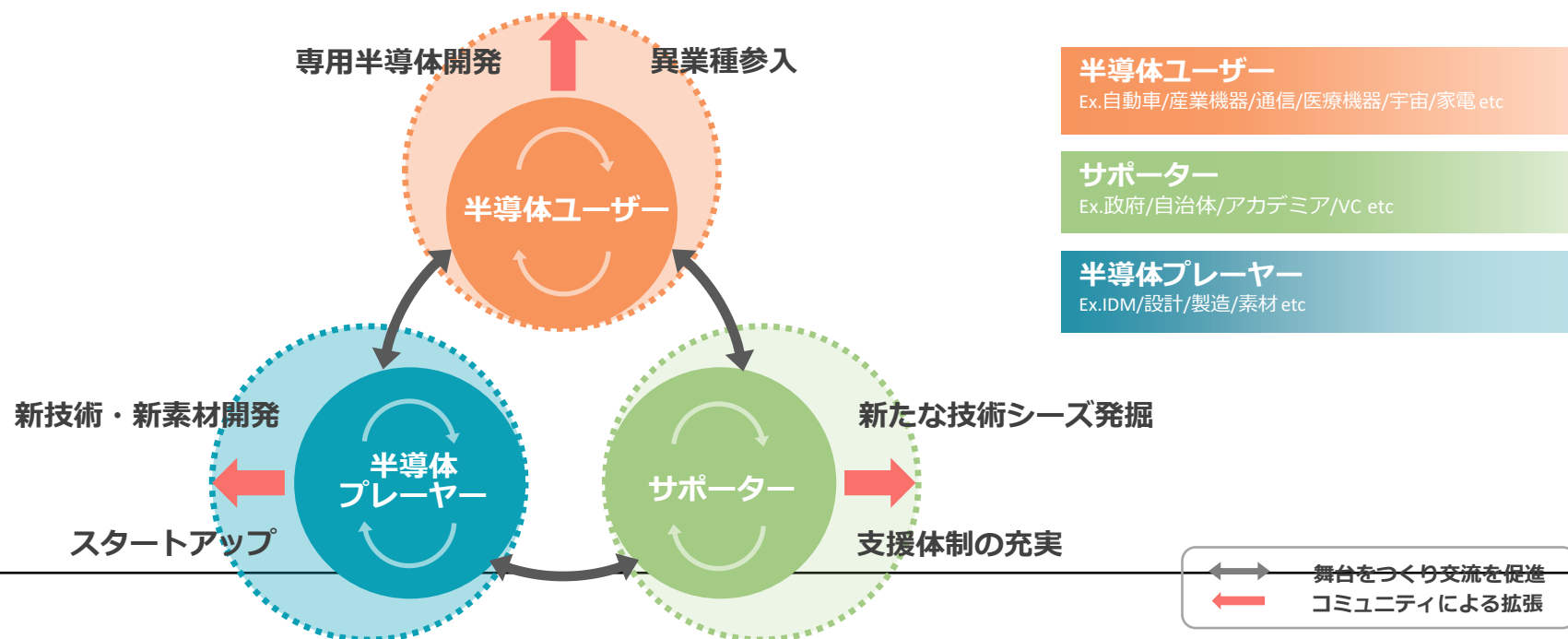


一般社団法人RISE-A (Revolutionary Innovation by Semiconductor Ecosystem for All Industries)

6月設立登記完了、7月プレスリリース、10月拠点完成・本格活動開始

“半導体による産業イノベーション推進のエコシステムを構築し、日本の次世代産業競争力の強化に繋げる”

- 産業デベロッパー三井不動産として、LINK-J（ライフサイエンス）、CROSS U（宇宙）に次ぐ第三の産業支援コミュニティ。
- 狭義の半導体産業（設計・製造等の供給側）だけでなく、
広義の半導体産業（半導体を活用するユーザー側や、支援するサポーター側）も含めたエコシステム構築を目指す。



「不動産デベロッパー」から「産業デベロッパーへ」



Life Science Innovation Network Japan
2016年3月設立

イノベーション創出のためのエコシステム構築を目指す
ライフサイエンス交流プラットフォーム



交流・連携 → 育成・支援

STEP 1 集まる
STEP 2 つながる
STEP 3 育つ
STEP 4 はばたく

場の整備

集積交流拠点
ライフサイエンスビル



東京：13箇所 神奈川：1箇所 大阪：1箇所

研究開発拠点
三井リンクラボ



東京：6箇所 神奈川：1箇所 大阪：1箇所

コミュニティの構築

LINK-J特別会員数 929 企業・団体・個人	2024年Event実績 1151 件 オンライン713件 ※ハイブリッドを含む
公式website 13 万PV 月間ページビュー	メルマガ配信数 3.5 万人

※2023年12月31日時点の数値です





2022年9月設立

あらゆる分野のプレイヤーが宇宙プレイヤーになる
宇宙産業共創プラットフォーム



集まる → 交わる → 共創する → 拡大する

国内外から、宇宙ビジネスに携わる企業、スタートアップ、アカデミアなどが集まる。

宇宙ビジネスの周辺領域プレイヤーも呼び込み、幅広い交流や情報発信が促進される。

アクセラレーター、VCなども集結、最先端の技術と融合し様々なビジネスが生まれる。

イノベーションが加速し、宇宙関連領域のビジネスフィールドが様々な分野に拡大していく。

宇宙関連ビジネスのイノベーションを創出する「場」と「コミュニティ」を提供

場の整備

宇宙ビジネスを加速させる多様な「場」をご用意



X-NIHONBASHI

コミュニティの構築

ビジネスマッチングやイベント、プログラムなどを提供

2023年Event実績 308 件	特別会員数 311 ※ 企業・団体・個人	※2023年5月時点
	非宇宙領域の 会員数割合 約 7 割	



国内外・産官学の宇宙関連プレイヤーと最新の知・情報が集まるエコシステムを構築、ビジネスの拡大をサポート



Disclaimer

The Omdia research, data and information referenced herein (the “Omdia Materials”) are the copyrighted property of Informa Tech and its subsidiaries or affiliates (together “Informa Tech”) and represent data, research, opinions or viewpoints published by Informa Tech, and are not representations of fact.

The Omdia Materials reflect information and opinions from the original publication date and not from the date of this document. The information and opinions expressed in the Omdia Materials are subject to change without notice and Informa Tech does not have any duty or responsibility to update the Omdia Materials or this publication as a result.

Omdia Materials are delivered on an “as-is” and “as-available” basis. No representation or warranty, express or implied, is made as to the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information, opinions and conclusions contained in Omdia Materials.

To the maximum extent permitted by law, Informa Tech and its affiliates, officers, directors, employees and agents, disclaim any liability (including, without limitation, any liability arising from fault or negligence) as to the accuracy or completeness or use of the Omdia Materials. Informa Tech will not, under any circumstance whatsoever, be liable for any trading, investment, commercial or other decisions based on or made in reliance of the Omdia Materials.

Get in touch

Americas

E: customersuccess@omdia.com

08:00 – 18:00 GMT -5

Europe, Middle East & Africa

E: customersuccess@omdia.com

8:00 – 18:00 GMT

Asia Pacific

E: customersuccess@omdia.com

08:00 – 18:00 GMT + 8

Brought to you by Informa Tech

The Omdia logo is displayed in a large, bold, black font. It features a stylized 'O' that incorporates a circular arrow, followed by the letters 'M', 'D', 'I', and 'A' in a clean, sans-serif typeface.